

業 務

概 覽

我們為一間總部位於台灣的二手半導體製造設備及零件的統包解決方案供應商及出口商。自我們於2009年開始業務以來，本集團一直為客戶提供二手半導體製造設備及零件的統包解決方案，我們的客戶主要為不時需要改造及／或升級其生產系統的半導體製造商。除我們的二手半導體製造設備及零件統包解決方案服務作為本集團的主要收益來源外，我們的收益亦來自半導體製造設備及零件買賣。

下表載列於業績記錄期間本集團按業務類別劃分的收益明細：

	截至12月31日止年度			
	2015年		2016年	
	新台幣千元	%	新台幣千元	%
統包解決方案	881,099	85.9	1,094,222	89.4
買賣半導體製造設備及零件	144,820	14.1	129,072	10.6
總收益	<u>1,025,919</u>	<u>100</u>	<u>1,223,294</u>	<u>100</u>

本集團專注為客戶提供半導體製造設備及零件，包括熱爐管、顯影裝置及其他，用於半導體的前端製造過程、晶圓加工，如沉積、光阻塗佈及顯影。我們負責為客戶採購二手半導體製造設備及零件，作為我們綜合解決方案的一環。我們的二手半導體製造設備及零件統包解決方案主要基於一個領先日本製造商品牌的二手半導體製造設備及零件，我們自海外經銷商及其他海外統包解決方案供應商採購該等零件。我們的二手半導體製造設備由半導體製造商用於製造不同大小的硅片，該等硅片可組合及包裝成不同種類的半導體產品。各式各樣的產品均依賴半導體提供更高性能及功能，包括手機、個人數碼助理(PDA)、遊戲機、DVD播放機及許多其他數碼電子消費產品。

於業績記錄期間，我們的收益超過50%來自我們於紐約證券交易所、台灣交易所及聯交所上市的領先半導體製造商客戶。

根據弗若斯特沙利文報告，於2015年，我們貢獻收益新台幣8.8億元，佔台灣統包解決方案市場份額4.7%。此外，就日本品牌的二手半導體製造設備及零件而言，本集團被視為台灣領先統包解決方案供應商及進口商之一。

業 務

我們的競爭優勢

我們認為，以下競爭優勢過往已使我們達致成功，並將繼續推動我們的未來發展：

我們為台灣領先統包解決方案及日本品牌的二手半導體製造設備及零件供應商及出口商之一

我們為台灣領先統包解決方案及日本品牌的二手半導體製造設備及零件供應商及出口商之一，為半導體製造商提供二手半導體製造設備及零件的統包解決方案。我們提供一站式服務，包括(i)承辦成套生產線的擴展(工作範圍涵蓋設備供應、改造及翻新、安裝及測試生產線)；及(ii)維修或保養現有生產線內的若干部件或以單機方式供應設備和機器，從而為現有生產線升級。本集團按低於一手定制設備的具競爭力價格為客戶提供二手半導體製造設備及零件的統包解決方案。我們的二手半導體製造設備及零件統包解決方案使我們的客戶能力延長使用其已折舊的設備，而我們亦以較低價格為客戶提供符合其製造需要的經翻新及定制設備。

根據弗若斯特沙利文報告，於2015年，我們貢獻收益新台幣8.8億元，佔台灣統包解決方案市場份額4.7%。此外，就日本品牌的二手半導體製造設備及零件而言，本集團被視為台灣領先統包解決方案供應商及出口商之一。我們認為，此市場份額乃歸因於我們按照客戶的不同技術要求及規格定制翻新二手設備的能力。

我們的高級工程師及高級管理層訓練有素，在此品牌下處理二手半導體製造設備方面積累了豐富的工作經驗。在過去六年，憑藉在品牌下翻新二手半導體製造設備的專業知識和業務網絡和提供二手半導體製造設備統包解決方案的成本效益，本集團已經建立聲譽，成為這個品牌下在台灣向二手半導體製造設備提供統包解決方案方面領先的品牌。

我們的銷售團隊與客戶緊密合作，藉此了解彼等的生產需要，如特定半導體產品的應用及質量規格，以及其生產設施的預計產量。根據我們銷售團隊收集的資料，我們的技術支援團隊繼而編製一份定制技術協議，就半導體產品生產設施的規格及設計向客戶提供意見。

我們相信，我們的靈活性及以客戶為中心的方針使本集團得以把握因客戶的不同需要而湧現的商機，如更換其生產設備、擴大其現有產能及興建新生產廠房等。

業 務

我們擁有具經驗及穩定的管理層、一支具備技術專長的項目經理團隊及技巧熟練的僱員

於整個業績記錄期間，我們具經驗及穩定的管理層一直展現出色的業務管理能力，成功改善我們的研發能力。我們的管理團隊在半導體行業擁有深厚的行業知識及專長。

楊先生(我們的主席兼執行董事)及范先生(我們的執行董事兼副總經理)均於半導體行業及相關生產設備行業擁有逾15年經驗。在我們的主席及總經理的領導下，我們的管理團隊已成功地實施業務發展策略、抓緊日增的市場機遇，並已建立我們在台灣二手半導體製造設備行業的市場地位。

我們相信，能幹的管理團隊所具備的知識和豐富經驗及項目經理的技術專長連同我們技巧熟練的工程師，為我們於半導體製造設備行業提供重要的競爭優勢。

我們採用設有質量控制機制的全面質量管理系統，亦獲客戶認可

我們高度重視我們的二手半導體製造設備質量。我們已採用質量管理系統，以確保在製造工序的各個階段(包括採購二手半導體製造設備，外購設備零部件檢驗以及翻新、改造、現場或內部安裝、搬遷、保養、升級、維修及測試等工序檢驗)對產品採取嚴格的質量控制。有關我們質量控制機制的詳情，請參閱本文件「業務 — 質量控制」一節。

我們的良好質量管理獲得「ISO 9001：2008質量管理體系」認證的認定。我們相信，我們在整個服務流程中貫徹執行質量控制，已進一步提升客戶對我們產品的信心。於業績記錄期間，概無客戶因我們的產品質量問題而退回二手半導體製造設備。

我們的優質產品及客戶服務亦廣受客戶認可。經過多年的營運，我們已獲客戶頒授獎項，包括最佳戰略夥伴及認可業績獎，反映了我們的優質產品及服務。有關我們獎項及認可的詳情，請參閱本文件「業務 — 獎項及認可」一節。

我們亦已與主要供應商建立穩定關係

我們亦已與主要供應商建立穩定關係。我們向名列認可供應商名單的供應商(主要位於台灣、南韓及美國)採購及購買二手半導體製造設備零件。憑藉我們在二手半導體製造設備市場的供應商網絡，我們與供應商密切溝通以獲得最新的市場資訊，並就我們的二手半導體製造設備及零件統包解決方案按具競爭力的價格採購二手半導體製造設備。我們相信，我們與主要供應商的穩定關係亦有助我們維持市場競爭力。

業 務

業務策略

我們旨在維持及／或提升我們作為二手半導體製造設備及零件統包解決方案供應商的地位。我們計劃通過採納及實施以下策略以達成此目標：

加強銷售及把握中國及台灣二手半導體製造設備行業的新機遇

在中國持續的經濟增長及有利的政府政策推動下，對半導體製造設備的需求預期會持續增長。根據弗若斯特沙利文報告，台灣為最大半導體製造設備市場，佔全球市場合共四分之一，而台灣政府已立法保障本地半導體行業及鼓勵本地生產。我們相信，中國及台灣該類需求的可持續增長為我們提供二手半導體製造設備及零件統包解決方案帶來持續增長的機會。

我們有意透過以下方式加強銷售及把握提供二手半導體製造設備及零件統包解決方案的新機遇：(i)拜訪潛在客戶；(ii)與客戶分享有關技術發展趨勢的行業情報；(iii)就客戶的製造設備保養與擴充計劃提供援助；及(iv)派發營銷材料，如服務簡介小冊子。

於現有總部增建樓層

我們計劃於現有三層高連地庫的自置物業增建樓層，為位於台灣的總部擴建約1,574平方米。我們[編纂]淨額的[編纂]將用於增建樓層，包括設計、申請相關許可證、水電及安裝空調及消防系統，總建築成本約為新台幣48.7百萬元，我們計劃從[編纂]及內部資源的結餘申請淨收益約新台幣[編纂]百萬元為此發展計劃融資。我們可以根據台灣的相關法律法規，增建樓層第四層，約1,574平方米。本集團的資本支出主要包括購買建築物及辦公設備。本集團截至2017年及2018年12月31日止年度的估計資本支出，分別為增建樓層相關的新台幣48.7百萬元及零。

我們的董事確認第四層的40%將用於容納整體人數持續增長的僱員及工作站及存貨倉儲。我們目前具四個潔淨室用於翻新和修理日本品牌的二手半導體製造設備，容納空間將近飽和。於業績記錄期間，潔淨室截至2016年12月31日止兩個年度的使用率分別約為89.3%及76.8%。截至2016年12月31日止年度，本集團擁有的潔淨室的使用率持續下跌主要由於需要於客戶場地改造半導體製造設備的購買訂單增加。董事認為，我們提供統包解決方案的地點主要取決於客戶購買訂單的規格，而於業績記錄期間的潔淨室的使用率超過75%顯示，本集團可能於須在我們自有場地達成的購買訂單增長時耗盡空間。董事相信，新增潔淨室可增加我們日後準備處理更多客戶購買訂單的能力。我們的董事確認，第四層的30%至40%將因二手半導體製造設備的大小而用於建立一個潔淨室用於翻新和修理其他品牌的二手半導體製造設備。第四層的20%將由我們的研究團隊用於研究及測試其他品牌的二手半導體製造設備。我們的董事確認，毋須購買任何額外的輔助機器或安裝額外的工作設施，以提供其他品牌的統包解決方案。

業 務

根據弗若斯特沙利文報告，公司規模及工作設施為領先半導體製造商篩選供應商時考慮的關鍵因素。(即設置若干數量的潔淨室)我們相信，僱員增加有助提高我們的產能、加強營運效率及提升形象。

附註：

- (1) 截至2016年12月31日止兩個年度的使用率乃根據需使用潔淨室的半導體製造設備除以總產量計算，並假設同期所有潔淨室以全部產能運作。

透過償還貸款以維持穩健財務狀況及釋放流動資金

我們擬於業務營運中採納謹慎的財務策略。我們維持穩健財務狀況而避免承擔巨額負債，藉此達致可長期持續增長。

我們亦有意持續積極管理提供我們統包解決方案的程序及貿易應收款項，確保內部產生現金足以應付持續資本需求。董事認為，對資本承擔實施審慎財務管理可為股東帶來合理回報，同時確保我們可長期持續增長。鑒於未來利率走勢不明朗，我們的董事認為，本集團的財務表現及流動資金可能因以下因素而受到負面影響：(i)本集團的本金及利息付款可能增加；及(ii)倘本集團進行債務融資為本集團的業務擴張提供資金，則本集團於未來可能面臨借貸成本增加。此外，如本文件「財務資料－銀行借款」一節所詳述，主要解除銀行借款可使本集團在實施其業務目標上更具彈性。由於我們的董事亦認為，本集團於償還現有銀行借款後可以更優惠的條款向金融機構獲得具吸引力的債務融資。

有關彈性亦進一步改善我們處理本集團營運資金充足程度的狀況，有關詳情詳述於「財務資料－貿易應收款項天數及貿易應付款項天數潛在不相符」一節。董事相信，我們的證券改善將加強我們的公司影像及提升本集團股東對我們的財務信心。

持續的研發工作

我們將繼續加強我們的研發能力，並致力於現有產品組合和潛在新產品的技術開發，以鞏固及提升我們作為台灣領先日本品牌半導體製造設備及零件統包解決方案供應商之一的地位。為涵蓋更多增值產品，以及提升我們的核心技術及其適用性及可靠性，我們將投放更多資源(包括人力資源、硬件設備及軟件)用於研發。

自2015年起，我們已與ITRI展開合作，通過使用它們在UVC LED技術方面的專才，戰略性的提升我們的研發能力，有關我們與ITRI合作的詳情，請參閱本文件「業務－研發」一節。

業 務

聘請及擴大我們的熟練及技術人員團隊，並加強我們於半導體行業的專業知識

我們計劃透過增加僱員人數擴展營運規權，並預期於2018年6月30日前聘用14名額外員工，包括兩名工程師、十名高級工程師及兩名業務發展員工。於我們預期聘用以拓闊及深化我們的技術專業知識之工程師及高級工程師當中，視乎我們統包解決方案的市場需求，其部份可處理日本品牌下二手半導體製造設備，其部份可處理其他品牌下半導體製造設備，而其部份具備MOCVD技術知識。我們的董事認為，僱用具有MOCVD技術知識和經驗的工程師可以通過以下方式為本集團帶來益處：(i)憑藉他們的經驗和知識，我們可縮短提供MOCVD設備的處理時間；(ii)現有工程師可以向這些工程師學習MOCVD技術，並可增強整體員工的MOCVD知識，以提高我們的產能及質量；及(iii)本集團可以借助這些工程師的完善客戶網絡，與潛在客戶建立聯繫。我們亦預期聘用能與客戶緊密合作及了解客戶需求並根據其生產需要配合規格的業務發展員工。

董事相信，透過擴大我們的營運規模，我們將能夠(i)提供達至客戶要求的度身訂造解決方案；(ii)擴大我們的統包解決方案範圍；(iii)拓闊我們的客戶基礎；及(iv)增加我們的市場份額。由於台灣及中國為半導體製造的全球領先市場，我們大部份收益來自台灣及中國，根據弗若斯特沙利文報告，其半導體市場預期維持增長趨勢，將在本集團收益增長上支持本集團的財務表現。

我們的解決方案及產品

我們為位於台灣的二手半導體製造設備及零件統包解決方案供應商及出口商。我們的業務可廣泛分為兩個主要分部：(i)二手半導體製造設備及零件統包解決方案；及(ii)買賣二手半導體製造設備及零件。我們業務範圍的簡短描述如下：

(i) 二手半導體製造設備及零件統包解決方案

我們的統包解決方案指(i)採購及銷售經我們翻新、改造、安裝及／或定制以達至客戶規格的二手半導體製造設備及零件；及(ii)於客戶需要改造及升級其現有半導體製造設備時，進行的維修、升級及維護服務。

各半導體製造設備需要技術定制以配合現有生產線，以生產所須半導體產品。我們翻新自供應商購入主要為一間領先日本製造商品牌下的半導體製造設備。客戶於需要修改其半導體製造廠及生產系統(即擴大生產線、搬遷生產設施或轉移設備)時，不時需要我們的統包解決方案。我們的統包解決方案規格按客戶的生產規定定制。一般而言，我們向客戶提供保修期最多12個月。

業 務

客戶於向我們購入二手半導體製造設備後，可要求我們(i)改造其半導體製造設備；(ii)提供維修及維護服務；及(iii)自我們的存貨提供零件。

二手半導體製造設備及零件統包解決方案於各業績記錄期間貢獻我們總收益85%以上，一直為我們的主要業務分部。

(ii) 買賣半導體製造設備及零件

根據弗若斯特沙利文報告，領先半導體製造設備及零件製造商逐步淘汰其於較早期階段開發的半導體製造設備及零件生發，以追求技術進步，造出較大及較小的晶體管。然而，由於該等半導體製造設備及零件生產的硅片(例如200毫米及300毫米硅片)至今仍為廣泛使用的主流產品，市場供求將會不平衡。董事相信，儘管市場對200毫米硅片的需求不斷增加，半導體製造設備製造商重新建設生產線以生產200毫米半導體製造設備及零件並不具成本效益。儘管該等硅片的終端市場需求綻放，而該等硅片的半導體製造設備及零件供應減少，二手半導體製造設備及零件供應商的新興需求將填補需求。

我們在統包解決方案業務下透過以下渠道購入二手半導體製造設備及零件：(i)我們的海外經銷商；(ii)其他海外統包解決方案供應商；及(iii)我們客戶處置的二手半導體製造設備及零件。我們亦向台灣的代理或直接向零件製造商採購零件。就若干過剩二手半導體製造設備而言，我們會售予其他海外統包解決方案供應商。就若干過剩零件而言，我們認為我們有充足存貨水平，我們出售予(i)統包解決方案客戶(為半導體製造商)；(ii)其他海外統包解決方案供應商；及(iii)海外經銷商。

於決定我們自上述來源取得的二手半導體製造設備及零件是否用於我們的統包解決方案抑或於買賣業務出售時，我們經參考以下考慮作出決定：

- 我們的二手半導體製造設備及零件的收購成本
- 我們的二手半導體製造設備及零件的存貨水平及市場供應
- 我們預期二手半導體製造設備及零件的需求
- 二手半導體製造設備及零件的潛在採購訂單盈利能力

向海外統包解決方案供應商的銷售方面，我們參與買賣我們從二級市場及／或從我們的半導體製造設備製造商客戶收購的二手半導體製造設備及零件及定價政策，有關詳情於本文件「業務—客戶、銷售及營銷—定價政策」一節中闡釋。

因此，我們的客戶可能亦為我們的供應商。有關詳情，請參閱本文件「業務—客戶、銷售及營銷—若干主要客戶及供應商重疊」一節。

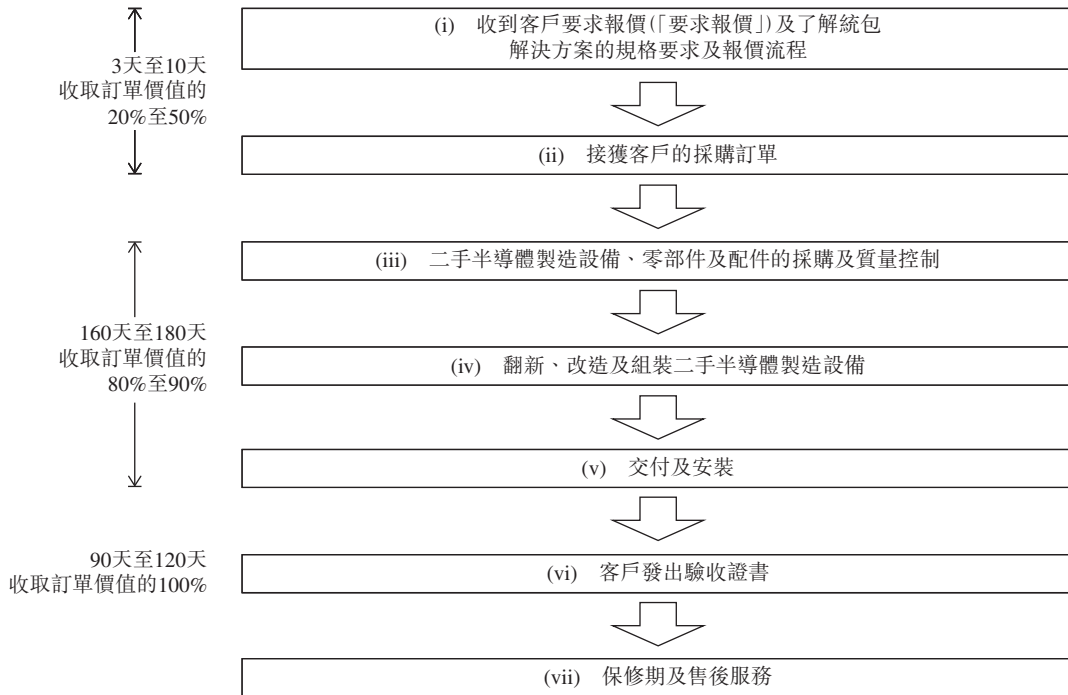
業 務

於業績記錄期間，買賣半導體製造設備及零件佔我們總收益約10.6%至14.1%。

我們的業務模式

一般而言，每個半導體製造設備需要定制以配合客戶不同半導體製造廠的生產線，我們的統包解決方案業務因以下理由受客戶需要帶動：(i)其生產線擴張計劃需要額外半導體製造設備及零件；及(ii)對現有生產線的日常維修、升級及維護。

下圖為我們業務內主要營運過程、交貨時間及結算安排的摘要：



(i) 要求報價及了解統包解決方案的規格要求及報價流程

我們的銷售團隊負責聯絡客戶及處理客戶及潛在客戶對生產和技術要求的查詢。我們的銷售人員大多具有半導體工程背景及技術知識，彼等能與客戶緊密合作，了解客戶需求並根據其生產需要配合規格。其後我們的銷售團隊將根據我們的理解透過ERP報價系統得出報價，並經由銷售經理批准。我們一般基於預計項目成本加上加成利潤率計算報價，而報價通常列明我們產品的詳細技術規格(包括每台機器的技術規格)及我們產品的測試標準、設備價格、我們的標準條款及條件以及付款期。我們的價格一般乃根據估計項目成本加差價率而制定。我們的報價通常自發出日期起30天有效。

業 務

(ii) 接獲客戶的採購訂單

我們透過簽署採購訂單確認接受客戶訂單。一般而言，我們的客戶須於我們接獲採購訂單後出具發票時首付訂單價值20%至50%的款項。

一旦我們確認採購訂單及接受客戶的首付款項，我們的專業團隊通常會根據項目規模組織一支由幾名工程師組成的團隊，包括每個項目的項目經理。至於每個項目，我們就產品交付列明協定及內部目標時限。我們的項目經理其後將向每名工程師或認可分包商中的員工分派工作。

(iii) 二手半導體製造設備及零件的採購及質量控制

在向採購部傳達採購查詢之前，應先獲得我們的管理團隊批准。每個採購查詢均隨附認可供應商名單中材料供應商的報價。我們根據供應商管理程序對任何新的供應商進行評估。根據收到的採購查詢及經確認我們存貨中若干材料的供應量，我們的採購團隊將準備一份採購清單，並採購設備、其他所需零件。所採購的零件乃因應我們的存貨而異。我們檢驗及處理對二手設備進行翻新和安裝所使用的零件。我們列明設備規格、數量、交付日期及付款期的採購訂單將在發送予供應商之前由我們的員工確認。我們的採購部將跟進交付情況，以確保二手半導體製造設備及零件如期送達。

(iv) 翻新、改造及組裝二手半導體製造設備

於最後實際可行日期，我們的技術部由50名工程師組成，主要負責按照客戶的規格翻新及定制二手半導體製造設備。於定制過程中，我們的工程師負責規格設及改造流程。我們的工程師會密切監控整個流程，並與客戶頻頻溝通，以確保所需規格符合客戶的要求。

在完成翻新後，每個半導體製造設備須在包裝及交付予客戶之前根據質量控制(即測試)程序接受內部檢驗，以確保我們的產品符合我們以及客戶嚴格的質量控制及規格。

(v) 交付及安裝

在通過我們的內部檢驗及檢查後，客戶可親臨我們的場地對製成品進行前期檢查，而一經客戶確認初步驗收後，我們會將產品打包並交付到客戶的場地以進行現場安裝。一般而言，客戶須於交付後支付訂單價值40%至60%作為產品交付款項。我們通常以陸路交通將產品運送至本地客戶、以空運及海運送達海外客戶，

業 務

並以陸路交通運送至台灣客戶。根據各自採購訂單，本集團或客戶可能須承擔運輸及保險成本。至於我們的海外客戶，當產品交付予客戶及我們完成安裝及即場測試時，貨物損失或損壞的風險會由我們轉移至我們的客戶。於業績記錄期間，我們在交付產品方面並無遇到任何重大中斷，致使我們蒙受損失或作出賠償。

在產品交付予客戶的製造基地後，我們的工程師將安裝半導體製造設備到客戶的生產線。我們的客戶其後進行測試，而倘有需要，我們的工程師負責進一步修改，直至客戶對設備功能及規格感到滿意為止。在正常情況下，安裝期為期兩個月，而測試期則為期一個月。

(vi) 客戶發出驗收證書

倘客戶滿意測試結果，彼等會向我們簽發驗收證書，以確認彼等接納我們的產品。一般而言，我們的客戶須於簽發驗收證書後進一步支付訂單價值10%至20%的付款。

(vii) 保修期及售後服務

我們的產品銷售通常於收到驗收證書後提供為期三至12個月的保修期。於保修期內，我們為客戶提供的服務包括技術支援、現場和非現場維修及保養以及免費提供非易損部件。我們就更換易損零件向客戶收費。有關我們統包解決方案的產品保證詳情，請參閱本文件「業務 — 客戶、銷售及營銷 — 產品保證」一節。我們亦向客戶對其現有半導體製造設備提供所須維修、升級及維護服務。

半導體製造工序及我們的統包解決方案

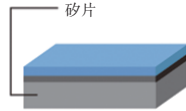
半導體製造工序大致上可分為(i)前端，包括晶圓加工及晶圓測試；及(ii)後端，包括包裝及測試。我們的統包解決方案主要包括用於前端晶圓加工的顯影裝置及熱爐管。

晶圓加工包括沉積、光阻塗佈及顯影等將電路裝配於硅片的工序。硅片其後會分離成獨立晶粒，封裝成集成電路，可用於數碼及電子產品。

業 務

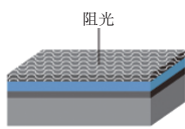
半導體製造工序前端硅片加工的一般步驟載列如下：我們目前的產品可用於下列步驟1及步驟2：

步驟1 氧化物及氮化物薄膜沉積*

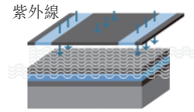


作為處理前期的程序，硅片表面被徹底清洗。然後進行熱處理，其中硅片表面會形成一層二氧化矽或氮化矽的薄膜。

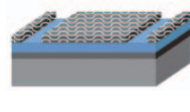
步驟2 形成圖案



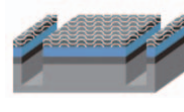
(i) 光阻塗佈*



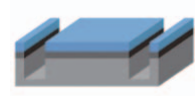
(ii) 曝光



(iii) 顯影*



(iv) 蝕刻*



(v) 灰化/清洗*

當硅片以高速旋轉時，其表面將均勻地形成一層光阻薄膜，屬於一種光感質，在暴露於紫外光下會改變其特性。

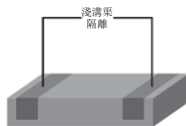
為將集成電路圖案移至硅片上，採用一個通過硅片上對準的圖案化光罩將紫外光照射到光阻層的設備。

暴露於紫外光的部分光阻層其後將採用顯影裝置以顯影液移除，並在硅片表面留下電路圖案。

等離子蝕刻系統根據剩餘阻光從硅片表面移除經暴露的介電二氧化矽/氮化物層。

在蝕刻後期工序中，殘留阻光會被移去，並將硅片浸入化學溶劑，以採用洗滌塔移除硅片上的粒子及雜質。

步驟3 形成隔離層



電介質層(二氧化矽)沉積到圖案化溝槽，以隔離個別晶體管(元素)

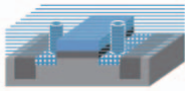
步驟4 形成間極



間極電介質層(氧化物)乃通過熱氧化形成，其上沉積了間極電極層(多晶矽)。

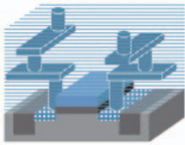
業 務

步驟5 形成接觸



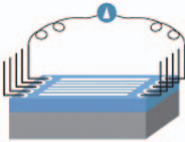
為了形成連接個別晶體管的佈線，首先電介質層(氧化物)會沉積在間極層，以便在其上形成另一層電路。然後，電介質層開了接觸孔並填滿金屬。

步驟6 互連配線



其上沉積另一層電介質層，並蝕刻溝槽以形成另一個佈線圖案。溝槽填滿金屬膜，然後將多餘的金屬拋光及整平表面。重覆進行該等工序以形成多層配線。

步驟7 驗證測試



每個集成電路以硅片探針進行測試，以找尋任何失效電路。

附註：

* 目前我們的產品可用於該等晶圓加工步驟。

於業績記錄期間，我們的統包解決方案及買賣半導體製造設備及／或零件主要涵蓋處理200毫米及300毫米直徑硅片的二手半導體製造設備。根據弗若斯特沙利文報告，基於以下原因，我們能夠於二手半導體製造設備行業立足：

- 儘管已有更大的硅片(如450毫米)，配合更小晶體管(如16毫米、14毫米)，200毫米及300毫米硅片仍為廣泛應用的主流硅片，原因是(i)較大的硅片仍在開發中；(ii)購買用於較大硅片的半導體設備新模型的高成本；及(iii)並非每個半導體設備都需要使用最新的集成電路型號運行。因此，預期將會繼續生產100毫米、150毫米、200毫米及300毫米硅片，而更大硅片的應用會越來越普遍，尤其是製造消費電子產品時可改善功能。此外，IP設計師會與半導體製造商就設備規格簽署合約協議。任何改動均會違反合約條款並影響生產線的質量控制。詳情請參閱「行業概覽—台灣附設統包解決方案的二手半導體製造設備市場的營業分析—(b)200毫米及300毫米半導體代工公司的市場機遇不斷增加」一節。



業 務

- 營運成本上升加重半導體製造商的財務負擔，翻新半導體製造設備對製造商而言為更好的替代選擇，相對於購買全新的設備，購買翻新設備的成本約50%至80%。因此，預期更多半導體製造商會選擇翻新設備，使半導體生產有更好的成本管理。

考慮到(i)業內仍在研究和開發450毫米硅片，(ii)其應用尚未於業內推出，以及(iii)轉型及開發以及相關成本巨大，故我們的董事認為基於本集團的規模，目前在處理450毫米硅片時分配資源和人力不具有成本效益。雖然本集團目前能夠提供450毫米硅片設備統包解決方案，半導體製造設備或零件，隨著未來科技愈趨成熟，本集團將為我們的工程師尋求外部培訓，使彼等可掌握處理更大硅片設備的知識，並使本集團有能力面對市場變化。

業 務

以下載列本集團於業績記錄期間向客戶出售的二手半導體製造設備及零件的主要種類：

設備種類	外觀	年份*	用途	本集團的翻新設備	一般價格範圍	客戶合約的平均規模	截至12月31日止年度	
							2015年	2016
					新台幣千元	新台幣千元	統包解決方案數量	統包解決方案數量
					新台幣千元	新台幣千元	的收益百分比	的收益百分比
擴散爐		Alpha-85 1996-1999 Alpha-85E 1998-2007	熱加工，在硅片表面形成一層二氧化矽或氮化矽的薄膜（即半導體製造工序步驟1的其中一部分）。	100毫米 至300毫米	60-14,455	7,931	41%	26%
顯影裝置		MK-8 ACT-8 1998-2007	以顯影裝置移除部分阻光層，因而在硅片表面留下電路圖案。	100毫米 至300毫米	32-46,763	13,229	35%	60%
其他(即清洗機及零件)		—	—	—	0.1-24,500	236	24%	14%
				總計			100%	100%
						881,099	1,094,222	

* 原產或製造年份

業 務

於業績記錄期間，我們的二手半導體製造設備擴散爐及顯影裝置統包解決方案合共貢獻收益分別約為新台幣666.3百萬元及新台幣941.8百萬元，分別佔我們來自統包解決方案的總收益約75.6%及86.1%。我們的產品組合亦包括清洗機(用以清除硅片表面的外來塵埃及微粒)及零件。

對日本半導體製造設備品牌的依賴

下表載列本集團於業績記錄期間半導體製造設備品牌的收益明細：

	截至12月31日止年度			
	2015年		2016年	
	新台幣千元	%	新台幣千元	%
日本半導體製造設備品牌	999,839	97.5	1,098,619	89.1
其他半導體製造設備品牌	26,080	2.5	133,675	10.9
總收益	<u>1,025,919</u>	<u>100</u>	<u>1,223,294</u>	<u>100</u>

根據弗若斯特沙利文報告，半導體製造設備供應商市場高度集中，按收入計算，五大參與者佔2015年總全球市場份額的63.9%。台灣方面，儘管原設備製造商也提供統包解決方案，統包解決方案供應商一般專門製造若干半導體製造設備品牌，因此需要具有設備的專門知識以取得業務。

我們出售的二手半導體製造設備主要翻新自一間領先日本製造商品牌的二手設備。於業績記錄期間，我們的總收益逾89%乃來自該品牌的二手半導體製造設備。

日本製造商的背景

日本製造商成立於1963年，為東京證券交易所上市公司，資本投資約550億日元，共有12,000名僱員。日本製造商於截至2015年及2016年3月31日止年度的銷售淨額分別約為6,131億日元及6,639億日元，截至2015年及2016年3月31日止年度的毛利分別約為2,428億日元及2,672億日元。於2010年至2016年，該公司的銷售淨額穩定增長，根據該日本製造商的預測，相信其銷售淨額於2017年將繼續增長。根據弗若斯特沙利文報告，於2015年，就收益而言，該日本製造商為全球五大半導體製造商之一，擁有約11.7%的半導體製造設備市場份額。其主要產品包括用於製造個人電腦，液晶電視和其他電子設備的半導體製造設備和平面顯示屏幕(FDP)生產設備。日本製造商在日本和世界各地擁有廣泛的銷售網絡，於日本設有8間公司，並於15個國家及美國、歐洲及亞洲等地區設有30間公司。於2016年財政年度，該公司獲得超過20項獎項並得到其業務夥伴及其他組織的認可。

業 務

我們的董事相信，我們對此品牌的依賴可以由商業理由解釋如下：

- (i) 整個行業格局由幾個主要品牌主導，使本集團等統包解決方案供應商難以打破對一個或多個主要品牌的依賴

據弗若斯特沙利文報告，半導體製造設備供應商市場高度集中，按收入計，五大品牌佔2015年全球市場份額的63.9%。於台灣，統包解決方案供應商通常專注於若干品牌的半導體製造設備，因此雖然原設備製造商也提供統包解決方案，彼等需要對半導體製造設備的具體知識以獲得業務。由於按2015年收入計，日本設備品牌的市場份額在全球半導體製造設備市場中排名第四，我們的董事認為儘管我們依賴其中一個主要品牌，我們的業務將可持續發展。

- (ii) 我們積累的行業聲譽和業務網絡源自我們在日本半導體製造設備品牌下提供有關二手半導體製造設備的統包解決方案的能力

根據弗若斯特沙利文報告，日本員工由於他們的工作文化，往往忠於其工作的公司，故此，職業流動性低於其他國家。日本製造商亦透過自建測試設備經營內部預測試平台，以達到更好質量控制和效率，而我們的董事認為有助日本品牌脫穎而出。本集團受惠於品牌的此類企業文化。我們的高級工程師及高級管理層訓練有素，在此品牌下處理二手半導體製造設備方面積累了豐富的工作經驗。在過去六年，憑藉在品牌下翻新二手半導體製造設備的專業知識和業務網絡和提供二手半導體製造設備統包解決方案的成本效益，本集團已經建立聲譽，成為這個品牌下在台灣向二手半導體製造設備提供統包解決方案方面領先的品牌。

對於與此類依賴相關的潛在風險，請參見「風險因素 — 有關我們業務及營運的風險 — 由於我們的二手半導體製造設備乃主要翻新自一個領導日本製造商品牌項下二手半導體製造設備，故我們可能有集中風險」一節。考慮到以下因素的影響，我們的董事認為本集團儘管涉及依賴有能力在未來維持其收入：

- (i) 我們的營運受益於可持續的業務營運，穩固的市場地位和日本半導體製造設備品牌的未來前景

日本品牌一直是全球主要半導體製造商，按2015年的收入計，約佔半導體製造設備的市場份額11.7%。根據弗若斯特沙利文報告。在2010年至2016年期間，該公司的銷售淨額按年復合增長率8%從約4,186億日元穩步增長至6,639億日元。基於日本製造商的預測，相信其銷售淨額將會穩定增長約8%，於2017財政年度年末達到7,140億日元。同時，日本製造商一直在半導體製造設備市場佔有穩固的市場地位，為全球前五大市場參與者之一。預計公司將繼續留在前五名。其在日本，歐洲和美國的先進研究設施及其最近與頂尖大學研究協會就半導體技術的合作，使

業 務

公司可進一步發展到不同的業務領域，同時加強當前的研發效果。根據弗若斯特沙利文報告，由於日本製造商在全球市場的強勢及穩固地位，預計其半導體製造設備品牌將保持競爭力。此外，它透過多年營運獲得強大的客戶群。由於選定半導體製造設備品牌的替換成本高昂，為確保產品質量一致，現有客戶亦不太可能將生產設施，包括半導體製造設備替換為其他品牌。因此，在短期內日本品牌的半導體製造設備存在不利變化或重大下降的風險輕微。

(ii) 穩定的客戶群是轉至其他半導體製造設備品牌的成本高昂及向日本半導體製造設備品牌收購新半導體製造設備的成本高昂的結果

我們部分客戶(主要是半導體產品製造商)一直在使用或意圖在其生產線中使用日本品牌的半導體製造設備，因此要求我們提供該二手半導體製造設備的統包解決方案，主要原因是(i)其生產線擴張計劃需要額外的半導體製造設備及零件；及(ii)日常維修、升級和維護現有生產線。根據弗若斯特沙利文報告，一般而言，不同品牌的二手半導體製造設備及零件不能互相替代，倘客戶替換已選定的半導體製造設備品牌，則可能要調整或修改生產線。已選定半導體製造設備品牌的替換成本龐大，由於客戶已經採用在功能上適合的品牌，替換半導體製造設備品牌並不常見，因為(i)採購另一個品牌的半導體製造設備成本高昂，而現有品牌的出售價值甚至可能折讓以快速售出，或(倘殘餘價值低)直接放棄，及(ii)一般而言，整個製造過程中涉及多於一間生產廠房。就系統兼容性而言，不可能只替換若干部分廠房代替為大多數情況招募全套新品牌，更別提具有大規模生產設備及複雜生產系統設計者。此外，客戶需要花費時間及精力去培訓員工及與其他服務供應商建立業務關係，因此各半導體製造設備品牌的客戶群穩定。另外，直接自半導體製造設備製造商購置全新的半導體製造設備的成本與收購為二手半導體製造設備及零件統包解決方案供應商(如本集團)帶來業務潛力和盈利能力的二手半導體製造設備統包解決方案相比之下較高。全新半導體製造設備、二手半導體製造設備及統包解決方案產品的收購成本因應不同半導體製造設備型號而有所不同。根據弗若斯特沙利文報告，二手半導體製造設備的收購成本一般約為50%或低於全新半導體製造設備，帶有統包解決方案的二手半導體製造設備則為全新帶有統包解決方案的半導體製造設備的50%至80%。

我們在應對與這種依賴相關的潛在風險方面的靈活策略

我們的董事相信，本集團有能力通過與我們的客戶和供應商的業務關係在其他品牌下複製其業務。我們的董事認為，我們的成功歸功於我們在行業中的聲譽，經驗和網絡。除了加強我們在處理日本品牌二手半導體製造設備的能力和聲譽外，我們亦不時探索其他品牌的二手半導體製造設備的商機。雖然本集團習慣翻新日本品牌下的二手半導體製造設備，我們的董事認為本集團亦保持靈活的策略，以應付未來客戶的需求變化和市場情況，確保本集團擁有網絡和經驗足以在其他品牌下採購和處理二手半

業 務

導體製造設備和提供統包解決方案作為備用方案。我們的董事認為，如果出於任何原因，本集團必須採購更大多數來自其他品牌的產品，我們將能夠複製我們的業務模式，原因如下：

(i) 現有供應商網絡

我們的董事確認，在我們認可名單上的供應商中，若干該等供應商(包括供應商A，其為我們截至2016年12月31日止兩個年度各年的五大供應商之一)能夠向我們提供其他品牌下的二手半導體製造設備。此外，供應商D於截至2015年12月31日止年度為我們的其中一名五大供應商，於韓國交易所上市，具有全球採購網絡，在超過20個品牌旗下擁有二手半導體製造設備存貨。我們的董事認為，於業績記錄期間與能夠以其他品牌提供二手半導體製造設備的供應商建立關係，有助本集團確保與過往採購量可比的穩定供應。根據弗若斯特沙利文報告，由於本集團的供應商(包括海外經銷商)通常參與買賣及提供多個品牌，預期本集團將能夠採購可比較過往購買量的其他品牌下二手半導體製造設備。於業績記錄期間，本集團加入全球行業協會(國際半導體產業協會)。董事認為該協會不僅有助我們連接及進一步擴闊供應商網絡，並與其他品牌的二手半導體製造設備供應商建立聯繫。

(ii) 我們的成功歸功於我們的聲譽，經驗和網絡

根據弗若斯特沙利文報告，世界領先的半導體製造商傾向於向公司規模較大，具先進的工作設施，業務關係更長和產品組合更廣泛的供應商採購。我們的董事確認，我們的客戶A和客戶B需要其他品牌的二手半導體製造設備的統包解決方案。考慮營運資金需求及與領先半導體製造商聯繫的經驗，與其他統包解決方案供應商相比，本集團公司規模較小，更能夠豐富我們的產品組合，滿足我們主要客戶的要求。考慮到我們在行業的聲譽，我們提供統包解決方案的經驗和我們的供應商網絡，我們的董事相信我們能夠發掘和發展與潛在客戶的關係。

(iii) 持續識別潛在品牌

於業績記錄期間，儘管本集團已從銷售日本設備品牌的二手半導體製造設備中獲得其收入逾89%，本集團亦提供其他品牌的二手半導體製造設備統包解決方案。根據弗若斯特沙利文報告，在這些品牌中，我們於截至2016年12月31日止年度向其中一名五大客戶提供荷蘭半導體製造設備品牌(2015年全球半導體製造設備市場排名第三)的統包解決方案。我們向其銷售已達至毛利率約20.0%。董事認為，我們來自以日本品牌及其他品牌提供統包解決方案的毛利率相似。

業 務

(iv) 銷售成本水平相近

我們的董事確認並無即時需要購買任何重大額外的輔助設備或安裝額外的工作設施，以提供其他品牌的統包解決方案。與提供其他品牌統包解決方案相關的主要成本包括：(i)其他品牌的二手半導體製造設備的採購成本；(ii)聘請有能力處理其他品牌半導體製造設備的額外工程師的勞工成本；及(iii)培訓工程師學習其他品牌的半導體製造設備規格的成本。於業績記錄期間，我們從其他品牌提供統包解決方案產生收益，而我們錄得二手半導體製造設備的採購成本與日本品牌相若。此外，我們將向認可名單上的現有供應商採購其他品牌的二手半導體製造設備，而我們預計其他品牌的二手半導體製造設備的採購成本將與日本品牌的二手半導體製造設備的採購成本相若。

於業績記錄期間，我們部分現有員工已能夠處理其他品牌的二手半導體製造設備，而我們已自透過其他品牌提供統包解決方案獲得收益。為了進一步加強我們在其他品牌下提供統包解決方案的能力，並為我們的工程師配備足夠的知識和技能處理其他品牌的半導體製造設備，本集團將須可(i)聘請具有提供其他品牌統包解決方案經驗的高級工程師；(ii)由具有提供其他品牌統包解決方案經驗的高級工程師領導提供內部培訓；及(iii)聘請外部顧問，以豐富我們工程師處理其他品牌二手半導體製造設備的技能和知識。我們的董事相信，本集團將需要約三個月來加強我們在其他品牌下提供統包解決方案的能力。董事相信，我們毋須聘用許多額外工程師以能夠提供其他品牌下的統包解決方案。我們的董事認為，統包解決方案的相關主要營運成本預期將與日本品牌的水平相若。

倘本集團任何理由須提供較大比重的其他品牌下二手半導體製造設備的統包解決方案，董事認為，由招聘及培訓工程師、購買其他品牌下相關半導體製造設備至提供其他品牌下二手半導體製造設備的統包解決方案的估計交貨時間約為三個月。基於(i)本集團已展示以具競爭力的價格從現有供應商網絡採購二手半導體製造設備的能力，(ii)我們的現有主要客戶(包括客戶A及客戶B)表示同樣需要其他品牌的二手半導體製造設備統包解決方案，(iii)我們具處理其他品牌二手半導體製造設備的經驗，及(iv)於業績記錄期間，我們以其他品牌提供統包解決方案產生收益，並錄得相似的毛利率，我們的董事相信，倘本集團需主要以其他品牌提供大量二手半導體製造設備統包解決方案，本集團能夠獲得可比的利潤率。然而，有關過渡仍須視乎熟悉其他品牌二手半導體製造設備技術的工程師是否充足以及市場內其他品牌統包解決方案需求。有關發展我們其他品牌的業務的相關風險，請參閱本文件「風險因素—有關我們業務及營運的風險—我們面臨提供其他品牌統包解決方案的相關風險，此可能會影響我們的業務及盈利能力」一節。

我們的董事認為，本集團將繼續將大部分資源分配於提供日本品牌的統包解決方案，此乃基於(i)根據弗若斯特沙利文報告，台灣的統包解決方案供應商通常專注於若干品牌的半導體製造設備及提供相關統包解決方案；(ii)本集團一直從日本品牌的可持續業務運營、強勁的市場地位及未來前景中獲益，並於業績記錄期間通過提供日本

業 務

品牌的二手半導體製造設備統包解決方案維持正面的毛利率；及(iii)我們積累的行業聲譽及業務網絡源自我們提供包括日本半導體製造設備品牌的二手半導體製造設備統包解決方案的能力，從而獲得穩定的客戶群。除了加強我們在處理日本品牌的二手半導體製造設備的能力及聲譽外，我們亦探索處理其他品牌的二手半導體製造設備的商機。於業績記錄期間，我們來自其他品牌的半導體製造設備的收益部分，由截至2016年12月31日止兩個年度的總收益的約2.5%增加至10.9%。展望未來，於實施本文件「業務—業務策略—於現有總部增建樓層」一節詳述的業務策略後，我們將繼續擴大我們統包解決方案的產品範圍，並將繼續提升我們處理日本品牌及其他品牌二手半導體製造設備的能力。我們的收益貢獻來自，並視乎我們客戶的需要及市場對日本品牌和其他品牌的統包解決方案的需求。

客戶、銷售及營銷

客戶基礎

我們的客戶基礎主要為半導體產品製造商，主要包括提供硅片加工服務的集成電路製造商。於業績記錄期間，我們的五大客戶包括(其中包括)客戶B(一家於聯交所及紐約證券交易所上市之公司)和客戶A(一家於香港聯交所及紐約證券交易所上市之公司)，兩間公司均為全球領先半導體製造商。

假設客戶定期進行檢查及保養，我們相信半導體製造設備可更耐用，及就會計而言壽命遠比其可使用年期長久。基於弗若斯特沙利文報告，半導體製造設備的可使用年期受限於多項因素，包括半導體製造設備的型號、檢驗頻密次數及預防維護等，大部分可使用年期可高達15年或以上。因此，統包解決方案對維持半導體製造設備的功能穩定性以及延長其可使用年期至為重要。客戶在計劃擴張生產或為其生產設施升級前，不大可能經常大額採購設備。由於我們為二手半導體製造設備的統包解決方案供應商，對我們解決方案的需求依賴下游半導體行業產品的需求。鑑於客戶使用我們的二手半導體製造設備及零件統包解決方案以製造半導體產品，該等行業的關鍵驅動因素將會同樣對我們產品的需求構成影響。我們相信，該等關鍵驅動因素包括(其中包括)世界經濟增長及技術進步。

由於台灣及中國為半導體製造的全球領先市場，我們大部份收益來自台灣及中國，根據弗若斯特沙利文報告。其半導體市場預期維持增長趨勢，將在本集團收益增長上支持本集團的財務表現。董事相信，客戶將繼續不時向我們購買額外統包解決方案，以增加其產能及升級其生產設施。

我們向客戶提供統包解決方案及/或買賣二手半導體製造設備及零件，我們的客戶主要為(i)半導體製造商；(ii)海外統包解決方案供應商；及(iii)半導體製造設備及/或零件貿易公司。

業 務

半導體製造商

我們的整體銷售主要由我們向世界各地不時需要改造及升級其生產系統的半導體製造商之銷售所推動。一般而言，我們的半導體製造商客戶要求我們的統包解決方案，以擴張生產線及對其現有半導體製造設備進行維修、升級及維護。

海外統包解決方案供應商

我們已與主要位於南韓的許可海外統包解決方案供應商名單維持客戶及供應商關係。儘管該等許可海外統包解決方案供應商的業務性質與本集團非常相似，董事認為，該等許可海外統包解決方案供應商(i)規模較本集團小；(ii)目標客戶不同；及(iii)從而在處理我們主要客戶(主要為全球領先的代工公司)的統包解決方案要求上並無與本集團競爭的能力。

在業績記錄期間，我們可能向其他統包解決方案供應商購買若干型號的二手半導體製造設備及零件，以在我們產能所限未能完成我們收到的所有採購訂單時，滿足我們從我們的客戶收到的採購訂單。

由於市場上可得的二手半導體製造設備及零件數量有限，統包解決方案供應商(包括本集團)與二手半導體製造設備及零件供應商建立良好的關係，有利於維持原材料供應渠道。與上述南韓統包解決方案供應商類似，本集團在定期庫存評估後，亦參與買賣我們從二級市場及/或從我們的半導體製造設備製造商客戶收購的二手半導體製造設備及零件及定價政策，有關詳情於本文件「業務—定價政策」一節中闡釋。

於業績記錄期間，本集團於考慮銷售成本的其他組成部份(包括相關運輸成本、存儲成本及於購入二手半導體製造設備時產生的匯兌虧損)後，以接近收購成本之銷售價買賣若干型號的二手半導體製造設備與該等海外統包解決方案供應商進行數次交易，並錄得虧損或毛利率較低。請參閱本文件「風險因素—有關我們業務及營運的風險—我們未必能夠維持來自與其他統包解決方案供應商買賣二手半導體製造設備及零件」一節。於業績記錄期間，來自該等海外統包解決方案供應商的收益約為新台幣56.3百萬元及新台幣35.0百萬元，分別佔整體收益的5.5%及2.9%，我們自此於相應期間產生負值或相對低毛利率分別約-4.9%及3.9%。根據弗若斯特沙利文報告，倘二手半導體製造設備模型的市場需求不大或二手半導體製造設備模型的需求預期將會減少，通常統包解決方案供應商不會以收購成本相約的價格出售二手半導體製造設備，以達致收支平衡或減低損失。董事認為，我們以接近我們收購成本的價格(根據弗若斯特沙利文報告，一般為一個新半導體製造設備原價的50%或以下)與該等海外統包解決方案供應商買賣半導體製造設備及零件，而不將銷售成本的其他組成部份轉嫁其他統包解決方案供應商的做法，將鼓勵彼等向我們買賣其剩餘二手半導體製造設備。有關詳情，請參閱本文件「業務—定價政策」一節。此外，鑑於購買各二手半導體製造設備的價值龐大，

業 務

我們董事認為，買賣剩餘二手半導體製造設備及零件對於本集團平台(i)維持市場客戶及供應商關係；(ii)產生撥出營運資金以在未來就提供統包解決方案購買其他具有更高盈利能力的二手半導體製造設備尤為重要。

雖然我們於業績記錄期間可能有時會以虧損或毛利率相對較低的價格將若干型號的二手半導體製造設備賣給其他統包解決方案供應商，但我們一直能夠就向我們的半導體製造設備製造商客戶(包括客戶A及客戶B)提供統包解決方案而自彼等採購大量其他指定型號的二手半導體製造設備，其毛利率顯著。於業績記錄期間，本集團錄得來自銷售二手半導體製造設備及零件予我們兩間主要其他統包解決方案供應商(即客戶D及客戶H)的負面及相對低毛利率。有關交易及相關金額的詳盡分析，請參閱本文件「業務—客戶、銷售及營銷—若干主要客戶及供應商重疊」一節。我們的董事將我們銷售予其他統包解決方案供應商造成的虧損及低利潤率視為我們業務營運中本集團承擔的部份經營開支及存貨風險。鑒於我們業務營運該等慣例，本集團已於業績記錄期間展示我們能夠維持整體正面毛利率。

半導體製造設備及／或零件貿易公司

我們與半導體製造設備貿易公司維持客戶及供應商關係，該等公司透過其分銷網絡專門與世界各地多間統包解決方案供應商及半導體製造商買賣半導體製造設備。

主要客戶

根據弗若斯特沙利文報告，二手半導體製造設備及零件統包解決方案需求預期將會增加，原因為(i)消費品分部的半導體的增長強勁；(ii)由於大型硅片加工設備的成本較高，小型硅片(如200毫米直徑)的需求依然強勁，尤其是中國用家；及(iii)為應對客戶所提出的嚴格要求及緊湊期限，半導體製造商預期將會更頻繁地翻新及改裝現時的生產設備。因此，我們預期我們產品的需求將穩定增長。

於業績記錄期間，來自五大客戶(為獨立第三方)的合計銷售收益分別佔我們總銷售收益的約新台幣825.5百萬元及新台幣1,001.4百萬元，分別佔我們總收益的約80.5%及81.9%。於業績記錄期間，來自最大客戶的銷售收益分別佔我們總銷售收益的約新台幣503.2百萬元及新台幣494.9百萬元，分別佔我們總收益的約49.0%及40.5%。

業 務

下表載列於業績記錄期間有關我們五大客戶的若干資料：

截至2015年 12月31日止年度 的五大客戶	主要業務	總部	購買產品 類型	建立關係 的年份	概約總 收益 新台幣千元	佔我們總 收益的概約 百分比%
客戶A(附註1)	於台灣交易所及紐約證券交易所上市之公司，提供硅片製造及技術服務。全球領先半導體製造商之一。	台灣	統包解決方案 (熱爐管及顯影 裝置)及零件	2010年1月	503,174	49.0%
客戶B(附註2)	於紐約證券交易所及台灣交易所上市之公司，提供技術服務以及製造200毫米及300毫米硅片。全球領先半導體製造商之一。	中國	統包解決方案 (熱爐管及顯影 裝置)及零件	2013年3月	146,902	14.3%
客戶C(附註3)	一間於紐約證券交易所及聯交所上市之公司之附屬公司，提供硅片製造及技術服務。	中國	統包解決方案 (顯影裝置)及 零件	2010年9月	81,715	8.1%
客戶D(附註4)	私營有限公司，從事二手半導體製造設備供應、翻新及安裝服務。	南韓	二手半導體製 造設備及零件	2013年6月	47,616	4.6%
客戶E(附註5)	於台灣交易所上市之公司，提供硅片製造服務。	台灣	統包解決方案 (熱爐管)及零 件	2010年1月	46,082	4.5%

業 務

截至2016年 12月31日止年度 的五大客戶	主要業務	總部	購買產品 類型	建立關係 的年份	概約總 收益 新台幣千元	佔我們總 收益的概約 百分比%
客戶B(附註2)	於紐約證券交易所及台灣交易所上市之公司，提供技術服務以及製造200毫米及300毫米硅片。全球領先半導體製造商之一。	中國	統包解決方案 (熱爐管及顯影 裝置)及零件	2013年3月	494,913	40.5%
客戶A(附註1)	於台灣交易所及紐約證券交易所上市之公司，提供硅片製造及技術服務。全球領先半導體製造商之一。	台灣	統包解決方案 (熱爐管及顯影 裝置)及零件	2010年1月	325,555	26.6%
客戶F(附註6)	一間於櫃買中心上市之公司之附屬公司，提供硅片製造及半導體製造服務。	台灣	統包解決方案 (熱爐管及顯影 裝置)及零件	2010年3月	77,722	6.4%
客戶G(附註7)	一間於台灣交易所上市之公司之附屬公司，提供硅片製造及技術服務。	台灣	統包解決方案 (熱爐管及顯影 裝置)及零件	2009年12月	68,262	5.6%
客戶H(附註8)	私營有限公司，從事二手半導體製造設備供應、翻新及安裝服務。	南韓	二手半導體製 造設備及零件	2010年10月	34,904	2.9%

附註：

1. 客戶A為全球半導體行業代工板塊的領先半導體製造商之一，根據其年報，(i)客戶A截至2015年12月31日止兩個年度的收益分別約為新台幣7,628億元及新台幣8,435億元，(ii)於美國、歐洲、日本、中國、南韓及印度提供服務，於2015年底全球僱員超過45,000名，及(iii)其估計市場份額為55%。我們與客戶A的一間附屬公司(客戶A1)建立業務關係。我們自2010年1月及2010年8月起分別與客戶A及客戶A1開展業務關係。
2. 客戶B為全球領先半導體製造商之一。根據其年報，(i)截至2015年12月31日，該公司於上海、北京、深圳及天津設有晶圓代工廠，並於美國、意大利、日本、台灣及香港設有辦公室，全球僱員超過13,000名，及(ii)客戶B截至2015年12月31日止兩個年度的收益分別約為新台幣618億元及新台幣

業 務

702億元。我們與客戶B的三間附屬公司(客戶B1、客戶B2、客戶B3)建有業務關係。我們自2013年3月、2014年5月及2013年9月起分別與客戶B1、客戶B2及客戶B3開展業務關係。

3. 根據一名獨立搜查代理提供的資料，客戶C(i)為外資企業，乃於2001年註冊成立及(ii)該客戶之註冊資本約為新台幣119億元。截至2015年12月31日止兩個年度其控股公司的收益分別約為新台幣1,440億元及新台幣1,448億元。
4. 客戶D為位於南韓的統包解決方案供應商，於業績記錄期間亦為我們的五大供應商之一，於本文件命名為供應商A。根據一名獨立搜查代理提供的資料，客戶D(i)乃於1992年註冊成立，資本約為新台幣42.0百萬元。
5. 根據一名獨立搜查代理提供的資料，客戶E乃於1994年註冊成立，於2015年底有超過3,800名僱員。根據其年報，(i)按2015年收益計算，其為全球十大半導體製造商之一，及(ii)其收益來自台灣、新加坡、中國、美國、日本、奧地利、菲律賓、瑞士、南韓及其他國家，及(iii)其截至2015年12月31日止兩個年度的收益分別約為新台幣239億元及新台幣233億元。
6. 根據一名獨立搜查代理提供的資料，客戶F乃於2008年註冊成立，有超過1,500名僱員。根據其控股公司的年報，(i)其控股公司截至2015年12月31日止兩個年度的收益分別約為新台幣401億元及新台幣411億元，及(ii)按2015年收益計算，其控股公司為全球十大半導體製造商之一。
7. 根據一名獨立搜查代理提供的資料，客戶G(i)乃於1985年註冊成立，及(ii)此客戶的資本為新台幣60億元，有約900名僱員。根據客戶G的控股公司的年報，其控股公司截至2014年12月31日止三個月及截至2015年12月31日止年度的收益分別約為新台幣749.9百萬元及新台幣32億元。
8. 客戶H為一間位於南韓的統包解決方案供應商，亦為我們於業績記錄期間的五大供應商之一，於本文件中命名為供應商A。根據一名獨立搜查代理提供的資料，客戶H(i)於2004年成立，有約20名僱員，(ii)該客戶的註冊資本約為新台幣20.0百萬元。
9. 於業績記錄期間五大客戶的若干資料及統計數據乃摘錄自其年報或一名獨立搜查代理所提供的資料。我們相信該等資料乃屬公平，且並無誤導成份，亦無遺漏致令該等資料出現錯誤或誤導成份的任何事實。我們、保薦人及[編纂]或任何有關[編纂]的其他方並無獨立核實該等資料，且並無對其準確性發表聲明。

於業績記錄期間，五大客戶並無與本集團產生壞賬。董事認為，基於以下因素，於業績記錄期間的五大客戶全部均具有足夠財務實力履行商業承諾，且並無我們應注意有關主要客戶的重大信貸風險：(i)我們與該等客戶的內部記錄及建立已久的關係；(ii)根據上市公開可得資料，其背景及財務資料；及(iii)由獨立搜查代理編製的五大客戶公司搜索報告。

業 務

於業績記錄期間，我們來自客戶B及客戶A的收益分別約為新台幣650.1百萬元及新台幣820.5百萬元，分別佔我們總收益的約63.3%及67.1%。根據弗若斯特沙利文報告，半導體製造商行業的市場高度集中，而我們的客戶基礎相對集中於幾大半導體製造商，彼等於半導體製造商行業佔據超過50%市場份額。因此，基於市場局勢，半導體製造設備供應商的潛在客戶基礎有限。

據董事所深知，於業績記錄期間，概無董事或主要行政人員或彼等各自的緊密聯繫人或於緊隨[編纂]完成後擁有已發行股份超過5%的任何股東，擁有業績記錄期間任何五大客戶的任何權益。

我們董事確認，本集團於業績記錄期間並無遇到任何客戶對銷售合約條款的重大違約或嚴重的訂單取消情況。

若干客戶及供應商重疊

於業績記錄期間，本集團通過以下渠道取得二手半導體製造設備及零件：(i) 半導體製造商處置的二手半導體製造設備及零件；(ii) 其他海外統包解決方案供應商；(iii) 海外分銷商。換言之，我們二手半導體製造設備及零件統包解決方案以及二手半導體製造設備及零件買賣業務的部分主要客戶亦為同期我們的二手半導體製造設備及零件供應商。

於業績記錄期間，我們的收益來自提供二手半導體製造設備及零件統包解決方案予客戶B、客戶D、客戶H、供應商B及供應商G以及二手半導體製造設備及零件買賣業務，彼等均為我們的二手半導體製造設備及零件供應商。

於業績記錄期間，客戶B為我們的五大客戶之一及我們的供應商之一。客戶B作為全球領先半導體製造商，根據其生產需求不時在市場以相對具競爭力的價格採購大量二手半導體製造設備以擴大產能，但客戶B未必會動用所有已採購的二手半導體製造設備。於有關情況下，客戶B可能於市場銷售多餘的二手半導體製造設備，我們則為二手半導體製造設備及零件統包解決方案向客戶B採購二手半導體製造設備。董事確認，我們在統包解決方案向客戶B提供的二手半導體製造設備並非我們向客戶B採購的二手半導體製造設備。

截至2016年12月31日止兩個年度各年，我們來自客戶B的收益分別為新台幣146.9百萬元及新台幣494.9百萬元，分別佔總營業額的約14.3%及40.5%。於業績記錄期間，客戶B向我們銷售二手半導體製造設備。截至2016年12月31日止兩個年度各年，我們自客戶B的採購分別為新台幣2.8百萬元及新台幣19.9百萬元，分別佔我們同期總材料成本的約0.3%及3.2%。我們提供予客戶B的統包解決方案條款與我們提供予其他客戶的相似。截至2016年12月31日止兩個年度各年，我們向客戶B提供統包解決方案平均毛利率分別約27.3%及18.5%。

業 務

於業績記錄期間，客戶D為我們截至2015年12月31日止年度的五大客戶之一以及截至2016年12月31日止兩個年度的五大供應商之一。客戶D主要為我們的供應商，佔我們截至2015年12月31日止年度的收益少於5%。據我們董事所悉，客戶D從事統包解決方案供應，與本集團類似的業務性質相似，但所針對的客戶規模、國家或地區有別於本集團。由於客戶D及本集團為統包解決方案的活躍市場參與者，於業績記錄期間，我們有時採購自客戶D，而客戶D亦向我們採購二手半導體製造設備及零件。

截至2016年12月31日止兩個年度各年，我們來自客戶D的收益分別約為新台幣47.6百萬元及新台幣0.6百萬元，佔我們總收益分別約4.6%及少於1%。於業績記錄期間，客戶J向我們銷售二手半導體製造設備。截至2016年12月31日止兩個年度，我們自客戶D的採購分別為新台幣362.4百萬元及新台幣146.2百萬元，分別佔我們同期總購買的約32.8%及23.8%。我們提供予客戶D的二手半導體製造設備及零件銷售條款與我們提供予其他客戶的相似。截至2016年12月31日止兩個年度，我們向客戶D提供二手半導體製造設備及零件的平均毛利率分別約-9.6%及24.7%。

於業績記錄期間，客戶H為我們於截至2016年12月31日止年度的五大客戶之一，並為我們於截至2016年12月31日止年度的五大客戶之一。我們的董事認為，客戶H主要為我們的供應商，僅佔我們於業績記錄期間的收益少於5%。據我們董事所悉，客戶H從事統包解決方案供應，與本集團類似的業務性質相似，但所針對的客戶規模、國家或地區有別於本集團。由於客戶H及本集團為統包解決方案的活躍市場參與者，於業績記錄期間，我們有時採購自客戶H，而客戶H亦向我們採購二手半導體製造設備及零件。董事確認，概無我們提供予客戶H的統包解決方案內二手半導體製造設備與我們從客戶H購買的二手半導體製造設備相同。

截至2016年12月31日止兩個年度各年，我們與客戶H的收益分別為新台幣8.6百萬元及新台幣34.9百萬元，分別佔總收益的約0.8%及2.9%。截至2016年12月31日止兩個年度各年，我們自客戶H的採購分別為新台幣18.5百萬元及新台幣109.0百萬元，分別佔我們同期採購額的約1.7%及17.7%。我們提供予客戶H的二手半導體製造設備及零件銷售條款與我們提供予其他客戶的相似。截至2016年12月31日止兩個年度各年，我們向客戶H提供二手半導體製造設備及零件的平均毛利率分別約21.3%及3.7%。有關我們與客戶H的業務詳情，請參閱本文件「業務 — 客戶、銷售及營銷 — 海外統包解決方案供應商」一節。

業 務

董事確認，雖然客戶D亦提供統包解決方案而且業務模式與本集團相似，但客戶規模較小，目標客戶不同，並無能力與本集團競爭處理我們主要客戶的統包解決方案要求。有關我們與客戶D的業務詳情，請參閱本文件「業務—客戶、銷售及營銷—海外統包解決方案供應商」一節。此外，我們的主要客戶(客戶A及客戶B，均為全球領先半導體製造商)篩選供應商時有嚴格要求，如良好往績、供應商的公司規模及與供應商建立業務關係的時間。我們與客戶A的業務關係逾六年，與客戶B的業務關係逾三年。

於業績記錄期間，供應商B為我們截至2015年12月31日止年度的五大供應商之一以及截至2016年12月31日止兩個年度的五大客戶之一。董事認為，供應商B主要為我們的供應商，僅佔我們於業績記錄期間的收益少於5%。據我們董事所悉，供應商B從事二手半導體製造設備買賣。於業績記錄期間，我們有時採購自供應商B，而供應商B亦向我們採購二手半導體製造設備及零件。董事確認，概無我們於向供應商B提供的統包解決方案中的二手半導體製造設備與我們向供應商B購買的二手半導體製造設備相同。

截至2016年12月31日止兩個年度各年，我們來自供應商B的收益分別約為新台幣9.9百萬元及新台幣2.7百萬元，佔我們總收益分別約1.0%及0.2%。截至2016年12月31日止兩個年度各年，我們自供應商B的採購分別約為新台幣79.0百萬元及新台幣24.0百萬元，分別佔我們同期總購買的約7.1%及3.9%。我們提供予供應商B的二手半導體製造設備及零件銷售條款與我們提供予其他客戶的相似。截至2016年12月31日止兩個年度各年，我們向供應商B提供二手半導體製造設備及零件的平均毛利率分別約31.9%及30.2%。

於業績記錄期間，供應商G為我們截至2016年12月31日止年度的五大供應商之一以及截至2016年12月31日止年度的五大客戶之一。董事認為，供應商G主要為我們的供應商，僅佔我們於業績記錄期間的收益少於5%。據我們董事所悉，供應商G從事二手半導體製造設備買賣。於業績記錄期間，我們有時採購自供應商G，而供應商G亦向我們採購二手半導體製造設備及零件。董事確認，概無我們於向供應商G提供的統包解決方案中的二手半導體製造設備與我們向供應商G購買的二手半導體製造設備相同。

截至2016年12月31日止兩個年度各年，我們來自供應商G的收益分別約為零及新台幣22.7百萬元，佔我們總收益分別約零及1.9%。截至2016年12月31日止兩個年度各年，我們自供應商G的採購分別約為新台幣31.7百萬元及新台幣36.3百萬元，分別佔我們同期總購買的約2.9%及5.9%。我們提供予供應商G的二手半導體製造設備及零件銷售條

業 務

款與我們提供予其他客戶的相似。截至2016年12月31日止兩個年度各年，我們向供應商G提供二手半導體製造設備及零件的平均毛利率分別約零及25.0%。

於業績記錄期間，我們並無與客戶訂立任何長期銷售合約，而我們相信此與市場慣例一致。

銷售及營銷

於最後實際可行日期，我們的銷售及營銷團隊由17名僱員組成。我們的銷售團隊負責與客戶聯絡並處理其查詢、跟進銷售訂單、安排送貨及物色潛在客戶。一旦我們獲得客戶的銷售訂單，我們的銷售員工將採取措施以確保適時處理銷售訂單。我們的銷售員工需要與項目經理及質量控制人員保持密切聯繫，以確保製成品將如期交付。我們的銷售員工會定期聯繫客戶以維持業務關係。我們亦邀請主要及潛在客戶到訪我們的設施，包括台灣的倉儲及潔淨室、與我們的執行董事及高級管理人員進行互動，並提高彼等對我們產品及服務的了解。

我們透過直接銷售向客戶銷售產品。我們的銷售團隊負責與現有及潛在客戶聯繫，並就潛在銷售收集資料，如與客戶聯繫以邀請其報價。根據所收集的資料，我們以ERP報價系統估計產品的生產成本，然後再參照目標利潤及產品的現行市價編製產品的報價。一經管理團隊的批准我們其後將以傳真或電郵將報價發送予客戶。一旦彼等同意我們的報價，我們的客戶其後將向我們發出採購訂單。

於業績記錄期間訂立的一般銷售合約的主要條款

以下載列本集團於業績記錄期間訂立的一般銷售合約的主要條款：

- **交付日期：**我們大部份產品的銷售合約一般設有交付日期，通常為我們接獲客戶的採購訂單後約10周。我們不時可能被要求根據客戶提前完成或延期的項目時間表交付產品。
- **付款期：**我們的客戶通常須於下列階段作出分期付款：(i)於我們接獲採購訂單後出具發票時首付訂單價值20%至50%的款項；(ii)於我們交付產品予客戶後支付訂單價值40%至60%的產品驗收款項；及(iii)於我們收到客戶的驗收證書後支付訂單價值10%至20%的最後付款。

業 務

- **交付及包裝：**我們通常須需於合約所載或由客戶通知的交付日期，按照本集團與客戶之間的銷售合約或技術協議所規定的議定包裝標準，將產品交付到客戶。
- **現場安裝及測試：**產品的現場安裝及測試通常於產品交付後的指定期限內，由我們的工程師或由客戶根據我們的技術指引進行。於通過現場安裝及測試程序後，我們的客戶須根據合約規定向我們簽發產品驗收證書。
- **保修期：**在此期間，倘我們的產品出現任何因翻新過程的任何缺陷而引致的任何質量問題，我們將免費提供現場勞動服務及非易損部件。我們的合約通常附有於通過現場測試並由客戶驗收產品後有三至12個月的保修期。
- **糾紛解決：**本集團與客戶之間的任何糾紛應首先通過談判解決，在談判失敗的情況下，各方可訴諸仲裁或訴訟方式解決。

結算及信貸期

我們的銷售主要以美元或新台幣(台灣客戶)及美元(中國客戶及其他海外客戶)的電匯方式結算。

根據銷售合約的條款，我們要求客戶根據若干進度作出分期付款。我們一般授予客戶30至90天的信貸期。我們的客戶主要以電匯進行付款。客戶可能延遲支付分期款項，且鑒於我們仍未償還並已逾期的貿易應收款項，故我們可能有向若干客戶授予信貸展期。於業績記錄期間，我們的貿易應收款項的周轉天數分別為76.6天及56.5天。於各報告期末，我們的貿易應收款項總額分別約為新台幣201.8百萬元及新台幣182.0百萬元。我們的董事認為，上述延期付款及我們的收益確認政策為導致我們貿易應收款項及應收票據的周轉天數相對較長的主要原因。有關貿易應收款項的進一步分析，請參閱本文件「財務資料—綜合財務狀況表內各項目的分析—貿易應收款項及應收票據」一節。

流動資金管理政策

於業績記錄期間，本集團一般會於收到我們為客戶準備購買的半導體製造設備及零件時，確認應付供應商的款項。同時，我們的客戶通常被要求按三期分期付款，請參閱「業務—客戶、銷售及營銷—於業績記錄期間訂立的一般銷售合約的主要條款」一節。一般而言，我們僅於完成我們統包解決方案的有關工作階段後，方才根據我們的收益確認政策確認來自我們客戶預付的應收款項為收益。尚未確認為收益的付款金

業 務

額將確認為預收款項，導致相對較少金額的收益確認為貿易應收款項。該等預收款項僅於交付統包解決方案及發出核證報告後，方能進一步確認為貿易應收款項。於2015年及2016年12月31日，我們的預收款項分別約為新台幣632.3百萬元及新台幣200.5百萬元，顯著高於相關日期內貿易應付款項分別約新台幣109.7百萬元及新台幣178.9百萬元。於業績記錄期間，我們並未於正常業務過程中清償我們應付款項及於到期時償還我們銀行借款時遇到任何流動資金問題。本集團認為，我們的三期分期付款期限乃為我們的流動資金管理政策，能增強本集團的流動資金狀況。我們董事認為，本集團維持充裕的營運資本且並無流動資金問題。

本集團亦已透過建立每月末監察貿易應收及應付款項賬齡分析的內部控制，加強我們的流動資金管理政策。貿易應收及應付款項的賬齡分析將定期提交予管理層作審閱及批准。

就已逾期貿易應收款項而言，重大到期付款按個別基準持續監察及評估，並基於客戶的一般付款處理程序、我們與客戶的關係、其過往付款記錄、其財務狀況以及一般經濟環境採取適當跟進行動。收回到期貿易應收款項的跟進行動包括(i)主動與客戶的適當人員溝通，例如負責處理付款的相關部門；(ii)於各報告期末審閱各個別貿易應收款項結餘，以確保就無法收回款項計提充足減值虧損撥備；及(iii)於需要時尋求法律建議。

就我們的貿易應付款項管理而言，我們將謹遵以下事項以確保適時向供應商付款：(i)一旦收到發票就付款編製及批准付款申請表；(ii)每月審閱貿易應付款項的賬齡分析；及(iii)應就任何未償付應付款項進行調查及結算，除非獲供應商通知或有特別情況。

倘任何逾期應收款項無法收回，及倘本集團並無足夠營運資金以適時支付供應商，本集團將須動用未動用銀行融資以向供應商付款。因此，本集團擬透過定期評估營運資金充足程度以加強我們的現金狀況。我們將於需要時提出跟進行動，例如購買較少半導體製造設備或延長信用額度作為後備計劃，以確保於大量逾期應收款項無法收回時有足夠營運資金。

產品保證

銷售合約通常於客戶發出驗收證書後提供三至12個月的保修期。於保修期內，對於出現任何缺陷的設備，我們會免費為客戶提供勞動服務及非易損部件。一旦保修期屆滿，我們亦繼續為客戶提供服務，但將會按時收費。

業 務

根據我們的保證撥備政策，保證撥備乃根據預期將於產品保修期內產生的估計成本作出。於業績記錄期間，我們作出保證撥備分別約新台幣34.2百萬元及新台幣18.5百萬元，而我們已實際使用的保證成本分別為約新台幣26.9百萬元及新台幣17.9百萬元。

定價政策

我們的定價乃按個別項目而釐定。在編製報價時，我們採用內部ERP系統以取得各部門的報價並為客戶得出最終報價。我們的價格乃一般根據二手半導體製造設備成本、目標利潤及產品的現行市價而釐定。

我們採納成本加成定價模式，而於釐定適當差額時，我們經計及客戶的可接受價格範圍，該範圍乃基於我們與客戶的過往交易及多項其他因素，例如規模、提供統包解決方案所須技術複雜程度及採購訂單的規格、我們的能力、與客戶的業務關係、估計成本(主要包括直接勞工成本及材料採購成本)、半導體製造設備及零件可取得程度及市場競爭。根據弗若斯特沙利文報告，翻新設備的售價一般約為全新設備售價50%至80%。

倘本集團擁有若干型號的二手半導體製造設備及零件庫存，我們的高級管理層可能會考慮在下列情況下在定期庫存評估後將其出售：

- (i) 買賣若干型號的二手半導體製造設備及零件被視為比保留用於提供我們的統包解決方案更有利可圖；
- (ii) 就該二手半導體製造設備提供統包解決方案未必非常有利可圖或客戶需求較小；及
- (iii) 在我們拆除一些有用的零件後就我們提供的統包解決方案買賣二手半導體製造設備。

在任何一種情況下，本集團出售的二手半導體製造設備及零件的售價最終均視乎市場需求及供應，並參考供應商及客戶之間的二手市場報價而定。

由於二手半導體製造設備及零件在市場上的供應有限，倘二手半導體製造設備及零件的需求高，我們將能夠以高於收購成本的價格為我們的統包解決方案定價。倘二手半導體製造設備及零件模型的供應充足，我們將僅能夠以收購成本之上較低利潤收費或按與本集團收購成本相約的價格出售，請參閱本文件「風險因素—有關我們業務及營運的風險—我們未必能夠維持來自與其他統包解決方案供應商買賣二手半導體製造設備及零件的正毛利率」一節。根據弗若斯特沙利文報告，倘二手半導體製造設備模型的市場需求不大或二手半導體製造設備模型的需求預期將會減少，通常統包解決方案供應商不會以收購成本相約的價格出售二手半導體製造設備，以達致收支平衡或減低損失。

業 務

營銷活動及客戶技術培訓

我們認為，產品被認定的質量及聲譽最為重要。我們主要通過下列方式推廣自己：(i)行內客戶的口碑；(ii)在我們的網站刊登有關本集團及產品的最新消息和資訊；及(iii)我們的銷售及營銷員工積極與潛在客戶溝通，以探討彼等是否需要我們的統包解決方案。上述各項均有助推廣我們的服務以及增加客戶對本集團的認知。

我們大部份二手半導體製造設備均定制至滿足客戶的要求。雖然我們相信我們大部分客戶在半導體機械作業方面具有內部鹿力，倘有要求，我們亦為客戶提供有關設備操作及日常保養的培訓。我們特別重視設備保養及培訓，並認為此能夠提升我們統包解決方案的整體吸引力，這可能提升我們的銷售工作。

原材料、供應商及採購

採購團隊

於最後實際可行日期，我們的採購團隊由8名成員組成。我們的採購團隊負責按照我們的業務需要採購二手半導體製造設備及零件。

原材料及供應商

於業績記錄期間，二手半導體製造設備及零件成本組成我們銷售成本的最大部份分別合共約為新台幣636.9百萬元及新台幣800.4百萬元，分別佔我們銷售成本的約78.5%及81.0%。我們採購二手半導體製造設備及零件自(i)海外經銷商、(ii)其他海外統包解決方案供應商以及(iii)客戶處置的二手半導體製造設備及零件。我們亦向台灣的代理或直接向零件製造商採購零件。

我們從一組認可供應商採購零件，藉此確保穩定的質量及準時交付。我們保持一份普遍位處台灣的認可供應商名單，而該等供應商乃基於其價格、準時交付記錄、質量及產能而選定。我們定期重新評估每名認可供應商。我們一般就主要零件保持多於一名供應商，藉此減低我們的成本及對任何一名供應商的依賴。於業績記錄期間，我們並無遇到零件供應的任何短缺或重大延誤。

一般而言，我們僅於收到客戶訂單後，才會採購二手半導體製造設備，並保存穩定的零件存貨。我們並無與供應商訂立任何長期採購協議。我們不時按照我們的需要向供應商發出採購訂單。我們藉著個別的採購訂單向供應商訂購二手半導體製造設備及零件，零件的信貸期一般為30至90天，而二手半導體製造設備方面，結算條款一般為我們要求客戶於下採購訂單時支付收購成本30%的預付款項，於發貨前支付60%，及

業 務

於我們接納後支付10%。我們主要以電匯向供應商付款。我們通常須於貨運前全數支付二手半導體製造設備。每份採購訂單列明所需二手半導體製造設備及零件的規格及質量。該等採購一般以美元或新台幣並有時候以日元結算。

於業績記錄期間，我們在我們的認可二手半導體製造設備及部件供應商名單上保留了1,100多家供應商，其中逾35家供應商有能力向我們提供二手半導體製造設備。截至2016年12月31日止兩個年度，我們向五大供應商的合計採購額分別佔我們二手半導體製造設備及零件的總採購額的約新台幣564.3百萬元及新台幣348.3百萬元。分別佔我們二手半導體製造設備及零件的採購總額的約51.1%及56.7%。截至2015年及2016年12月31日止年度各年，我們在若干程度上展示高度依賴二手半導體製造設備耗材的主要供應商。董事認為，有關依賴主要由於以下商業理由：

- (i) 在市場上二手半導體製造設備供應有限的情況下，我們與我們的主要供應商建立已久的關係

根據弗若斯特沙利文報告，由於市場上可得二手半導體製造設備及零件數目有限及因此對特定半導體製造設備型號的需求高，市場參與者通常就半導體製造設備及零件供應競爭，以適時向其客戶提供定制二手半導體製造設備。儘管我們部分二手半導體製造設備供應商(包括供應商A、供應商B及供應商F)能夠取得廣泛種類的二手半導體製造設備及零件(包括該等特定設備品牌及型號)，彼等所擁有二手半導體製造設備的可得性被視為本集團依賴其供應的主要原因。

- (ii) 我們傾向持續向具有良好往績記錄的供應商採購

根據弗若斯特沙利文報告，與二手半導體製造設備及零件供應商有良好關係的統包解決方案供應商在維持原材料供應渠道上更具優勢，及因此可透過提供廣泛種類的半導體製造設備予客戶而持續其統包解決方案業務。本集團盡力與我們的認可供應商維持關係，以取得二手半導體製造設備及零件的穩定供應。鑒於二手半導體製造設備的大額每單位收購成本及本集團的經營規模，我們與該等半導體製造設備供應商作出的任何大額採購訂單將導致本集團大量採購額，而有關供應商其後將於相關期間成為我們的主要供應商。

董事認為，儘管有關依賴，我們的業務將可持續及有關依賴將不會影響我們的業務前景，乃由於(i)有關依賴屬相輔相成；及(ii)我們自我們的供應商網絡採購的能力。

- (i) 相輔相成的依賴

董事於評估供應商的經營規模、目標客戶及在處理來自我們主要客戶的統包解決方案要求上與本集團競爭的能力時，保留一份認可供應商名單。儘管我們若干供應商(亦為統包解決方案供應商)的規模在經營規模及收益上較本集團小。鑒於以下理由，該等供應商在若干程度上依賴本集團：(i)來自本集團大額增長的收益貢獻；及(ii)本集團對其二手半導體製造設備及零件的需求，乃由於彼等未必有

業 務

渠道及相對經營規模以直接處理我們主要客戶(包括台灣及中國若干全球領先半導體製造商)的採購訂單。有關詳情，請參閱本文件「業務－客戶、銷售及營銷－海外統包解決方案供應商」一節。有關屬二手半導體製造設備及零件貿易公司的其他主要供應商而言，其部份規模相對本集團較大，亦有在買賣二手半導體製造設備及零件上類似海外客戶，然而，彼等並無我們的統包解決方案能力以為該等公司服務。董事認為，本集團受惠於該等供應商於我們提供統包解決方案中供應的二手半導體製造設備及零件應泛種類。有關詳情，請參閱本文件「業務－客戶基礎－半導體製造設備及／或零件貿易公司」一節。本集團認為，我們的主要供應商對我們統包解決方案原材料穩定供應的依賴屬相輔相成。董事認為，我們的主要供應商終止向我們供應在商業上並不明智。

(ii) 我們自我們的供應商網絡採購的能力

於業績記錄期間，本集團在我們的認可二手半導體製造設備及部件供應商名單上保留了1,100多家供應商，其中逾35家供應商有能力向我們提供二手半導體製造設備。董事認為，二手半導體製造設備的替代供應商(我們任何一間主要供應商除外)可容易覓得，乃由於我們已與彼等建立關係，我們亦可取得穩定供應，乃由於我們已於業績記錄期間展示我們的主要供應商之間更替。於業績記錄期間，本集團亦已加入加入全球行業協會(國際半導體產業協會)，使本集團可進一步擴闊我們的供應商網絡。

我們的董事認為，中國和台灣統包解決方案供應商市場的前景將在可見未來保持積極，因此即使考慮到我們對主要供應商的依賴，我們的業務仍屬可行。有關行業前景的進一步資料，請參閱本文件「行業概覽－台灣附設統包解決方案的二手半導體製造設備市場的營業分析」一節。

據董事所深知，於業績記錄期間，概無董事或主要行政人員或彼等各自的緊密聯繫人或於緊隨[編纂]完成後擁有已發行股份超過5%的任何股東，於我們任何五大供應商擁有任何權益。

業 務

下表載列於業績記錄期間有關我們五大供應商的若干資料：

截至2015年12月31 止年度的五大供應商	主要業務	總部	建立關係 的年份	概約總 採購金額 新台幣千元	佔我們總 採購額的 概約百分比
供應商A (附註1)	私營有限公司，從事二手 半導體製造設備的買賣 及統包解決方案供應。	南韓	2013年6月	362,374	32.8%
供應商B	私營有限公司，從事二手 半導體製造設備的買賣。	香港	2010年4月	78,971	7.1%
供應商C	私營有限公司，從事二手 半導體製造設備的買賣。	新加坡	2014年10月	43,936	4.1%
供應商D	於韓國交易所上市之 公司，從事半導體前端、 後端、顯示、LED、 太陽能及醫療行業各種 二手設備買賣。	南韓	2011年1月	42,304	3.8%
供應商E	私營有限公司，從事零件 的供應。	台灣	2009年12月	36,676	3.3%
截至2016年12月31日止年度 的五大供應商	主要業務	總部	建立關係 的年份	概約總 採購金額 新台幣千元	佔我們總 採購額的 概約百分比
供應商A (附註1)	私營有限公司，從事二手 半導體製造設備的供應。	南韓	2013年6月	146,159	23.8%
供應商F (附註2)	私營有限公司，從事二手 半導體製造設備的 供應。	南韓	2010年10月	108,976	17.7%
供應商G	私營有限公司，從事二手 半導體製造設備的買賣。	美國	2010年4月	36,277	5.9%
供應商H	於韓國交易所上市之 公司，提供洗滌器及 溫度控制系統	南韓	2016年10月	32,944	5.4%
供應商B	私營有限公司，從事二手 半導體製造設備的買賣	香港	2010年4月	23,988	3.9%

附註：

1. 供應商A為位於南韓的統包解決方案供應商，亦為我們於業績記錄期間的五大客戶之一，於本文件命名為客戶D。
2. 供應商F為位於南韓的統包解決方案供應商，亦為我們於業績記錄期間的五大客戶之一，於本文件命名為客戶H。

業 務

存貨

我們的存貨主要包括二手半導體製造設備及零件。一般而言，我們在收到訂單後按背靠背的基礎採購二手設備，但我們亦根據市況採購經常訂購的二手設備種類，以減低成本。我們通常保持六個月的零件存貨作為安全庫存，以應付預期客戶對我們設備翻新以及維修和保養服務的需要。我們密切監察存貨水平以滿足我們的需要、盡量減少浪費及避免積存過期存貨。我們緊貼有關現有零件預定工作量的最新資料，並按此制定採購計劃。如於本文件「業務 — 買賣二手半導體製造設備及零件」一節所述，儘管我們的庫存中僅原材料或會用於買賣二手半導體製造設備及零件業務，我們採購原材料的主要營運策略及目標為向半導體製造商提供統包解決方案，是本集團的主要收益來源，佔業績記錄期間我們整體收益逾80%。根據香港會計準則第2號，存貨按成本及可變現淨值兩者中之較低者計量。若用作生產存貨之材料及其他物料生產之成品的預計售價將等於或高於成本，則此等材料及其他物料將不會撇減至成本以下。可變現淨值估計乃按作出估計時所得最可靠之證據之估計可變現存貨金額。因此，管理層於評估各報告日期的存貨撥備時，已考慮上述營運策略及目的。在實踐中，管理層基於二手半導體製造設備及零件的收購成本與及可變現淨值中較低者，根據我們管理層於各報告日期以統包解決方案的方式可向半導體製造商售出之最佳估計，評估原材料的賬面值。倘成本高於相應可變現淨值，我們將於損益表將存貨撇減至可變現淨值。倘導致存貨撥備的因素已消失，而可變現淨值因此升至高於相應賬面值，我們將撥回撇減金額及於損益表中確認撥回。於業績記錄期間，我們於截至2015年及2016年12月31日止年度之撇減存貨分別約為新台幣20.2百萬元及零。

除我們按背靠背基礎採購二手半導體製造設備外，我們亦根據市況採購頻繁訂購的二手半導體製造設備及零件種類，以降低我們提供統包解決方案的成本。於任何情況下，本集團可能因於考慮銷售成本的其他組成部份(包括相關運輸成本、存儲成本及於購入半導體製造設備時產生的匯兌虧損)後以接近收購成本之銷售價買賣我們若干型號的二手半導體製造設備予我們的海外統包解決方案供應商而產生虧損。請參閱本文件「風險因素 — 有關我們業務及營運的風險 — 我們未必能夠維持來自與其他統包解決方案供應商買賣二手半導體製造設備及零件」一節。我們的董事認為，我們向我們海外統包服務提供商買賣二手半導體製造設備及部件業務佔我們總收益少於6%，而其中造成虧損的交易並非經常發生，且相關銷售額僅佔我們於業績記錄期間整體收益約2.2%及零。我們的董事認為，我們向其他統包解決方案供應商銷售二手半導體製造設備及部件所導致的負毛利率或低毛利率為本集團於我們業務經營過程中所承受

業 務

的經營開支及存貨風險的一部分。憑藉我們於業務經營中的有關慣例，本集團已證明我們能夠於業績記錄期間保持整體正面的毛利率。因此，我們的董事認為所有就存貨的會計撇銷已作出撥備，且整體存貨撇銷屬充足。

於2015年及2016年12月31日，我們的存貨結餘分別約為新台幣863.2百萬元及新台幣641.6百萬元，而我們的平均存貨周轉天數分別約為267.9天及274.1天。有關本集團存貨的詳情，請參閱本文件「財務資料—綜合財務狀況表內各項目的分析—存貨」一節。

質量控制

於最後實際可行日期，我們的質量控制團隊由6名成員組成。我們的質量控制團隊負責確保所有產品均通過質量控制流程並符合我們的標準。我們密切監控外購零件以及製造流程的質量，並對製成及出廠產品進行性能和可靠性測試，以確保符合客戶的規格要求。

外購材料質量控制

我們的質量控制團隊對所有外購原材料進行外觀及質量檢驗，以在使用前確保符合我們的質量標準。對於供應商根據我們的設計及規格製成並供應予本集團的該等零件，我們的質量控制團隊會檢查其外觀、尺寸及功能是否符合我們的設計、規格及規定的質量標準。任何零件或原材料若不符合質量標準，均將即時退還進行更換或退款。

工作流程及製成品質量控制

我們的質量控制團隊及工程師團隊按客戶要求報價及我們內部功能測試標準於翻新及重組過程進行半導體製造設備檢驗。我們的工程師將調整規格或更換零件，以符合客戶要求。所有測試結果將記錄於測試報告。我們的質量控制團隊對所有製成品進行內部測試，以確保製成品符合相關技術標準及客戶的規格。不符合相關質量標準的產品將要重新製造，並須於重新製造後再次接受內部測試。我們將就通過我們最終產品質量控制檢驗的製成品發出證書。

外輸材料質量控制

在收訖產品交付通知後及交付產品前，我們進一步檢驗及確認(i)符合客戶要求報價的重組及規格；(ii)功能測試結果；(iii)包裝清單；及(iv)設備的名稱及編碼。產品必須在外輸材料質量控制檢查中合格，才會交付予客戶。

業 務

我們的良好質量管理獲得「ISO 9001：2008質量管理體系」認證。我們的董事確認，於業績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無遇到任何重大的產品質量問題、索償、投訴或售後退回(因產品質量不合標準而致)。

風險管理

董事確認，於我們的日常業務過程中，我們主要面對(i)與我們整體監控系統有關的監控風險；(ii)與我們的業務有關的監管風險；(iii)營運風險；及(iv)與應收賬款有關的信貸風險。以下載列我們業務的主要風險及降低有關風險的內部監控程序：

風險控制

我們的風險登記冊已識別若干需要管理的風險，包括不適當及不一致的行為、未能發現不道德行為、錯失或潛在欺詐及未獲授權取得保密資料。為控制該風險，本集團已在員工手冊及本公司政策內作出批註，要求本集團全體董事及僱員遵守。

監管風險管理

於[編纂]後，本集團可能面對違反創業板上市規則的風險。我們已指派指定人員至少每年更新本公司政策的內容，並將創業板上市規則的新修訂本分派予全體董事及僱員。我們已委任豐盛融資有限公司為合規顧問，以就合規事宜向我們提供意見。全體董事及僱員將須至少每年參加培訓，以更新彼等對員工手冊及本公司政策的了解。本集團亦將聘請法律顧問，以就適用的香港法律及法規的合規事宜向我們提供意見。

營運風險管理

我們的執行董事及高級管理層負責維持營運及評估項目的營運風險。彼等負責執行我們的內部政策及程序。本集團重視道德價值以及防止欺詐和賄賂。我們經已設立舉報計劃，此舉將促進部門與業務單位之間的溝通以匯報任何違規行為。

信貸風險管理

倘我們的對手方未能履行責任，則本集團所面對的信貸風險可能會導致本集團蒙受財務損失。為將信貸風險降至最低，所有合約的付款條款必須獲董事批准。我們一般授予客戶30至90天的信貸期。此外，董事每月檢閱概述項目收支的付款報告。有關程序已被列入本集團的風險登記冊內，作為處理信貸風險的補救措施。在決定是否遞交投標及報價之前，本集團將考慮相關客戶的信譽度及合約條款等

業 務

因素。此外，執行董事亦考慮我們每名客戶的業務關係時間長短、過往信譽、財務實力及還款記錄。我們的項目經理及財務及會計部門會監察清付情況。就逾期未付的結餘，執行董事及項目經理將會加以注意，並將採取適當的跟進行動。當貿易應收款項結餘於協定的信用期後尚未清付時，則有關結餘將被歸類為逾期款項。於2015年12月31日及2016年12月31日，本集團作出有關貿易應收款項的減值撥備分別約新台幣82,000元及零。

研發

研究重點及預算

本集團一直不斷將財務資源分配至研發方面，繼而使我們能夠在二手半導體統包解決方案市場中維持市場地位及競爭力。我們統包解決方案的客戶通常有不同需求及規格，因此需要定制解決方案。故此，研發對於我們及時提供定制解決方案以滿足客戶需求尤為重要。

我們的研發工作專注於提升現有統包解決方案的有效性與質量，以滿足客戶的規格，並提升製造的成本效益。我們通過(i)我們的內部研發團隊；(ii)與外部研究合作夥伴合作物色具體研究課題以開展我們的研發活動。截至2016年12月31日止兩個年度，我們產生的研發開支分別約為新台幣3.7百萬元及新台幣4.5百萬元，佔我們於各期間的總收益分別約0.4%及0.4%。

(i) 我們的內部研發

我們設有一支由六名成員組成的內部研發團隊，於最後實際可行日期由范尚聖先生領導。有關范尚聖先生的資歷及經驗詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層—高級管理層」一節。我們的研發團隊定期接受培訓，並一般在設備製造業擁有經驗或從事研發相關活動。我們的研發團隊與我們的銷售團隊緊密合作以收集最新的市場資訊，包括最新的市場趨勢與發展、需求及消費者要求。

(ii) 與研究機構合作

自2015年10月起，我們與工業技術研究院訂立了合作協議，即委託開發契約書（「委託契約書」）及技術授權契約書（「授權契約書」），憑藉其在電子及光電子領域發展成熟的研究措施策略性地提升我們的研發能力。有關研究旨在解決製造UVC-LED所用MOCVD技術的外延問題。MOCVD設備（本集團於業績記錄期間正研發中）為用以半導體製造過程前期的半導體製造設備。隨著LED在終端產品市場越來越普及，許多半導體製造商擬改善終端產品市場的生產設備，以應付不斷增加的需求。有關研究正如期

業 務

進行，我們的董事相信，我們能於2017年年底前提供MOCVD設備。我們的董事確認，我們的部分客戶已表明對MOCVD設備的興趣，而我們現有的供應商網絡可為我們提供所需材料。通過是次合作，我們的工程師將獲得外延技術以改良我們的MOCVD技術，從而盡量減低我們的前期成本及相關風險，同時擴大我們的統包解決方案範圍。

委託契約書

自2015年10月19日至2017年9月18日，我們委託ITRI進行驗證UVC LED薄膜的有效性及其質量之研究（「此研究」）。委託費為新台幣8百萬元，並由我們承擔相關稅項。我們為ITRI的此研究提供外延設備，並由我們承擔修理及維護費用。我們派出一些工程師參與研究。所有來自我們執行此研究之產出，例如相關技術和文件，及其潛在專利、版權、商業機密及其他知識產權屬於我們，所有來自ITRI執行此研究之產出例如相關技術和文件，及其潛在專利、版權、商業機密及其他知識產權屬於ITRI（「研究成果」）。ITRI同意自簽訂委託契約書起十年內，我們可在光電技術範圍內使用、執行、改裝及修改研究成果。

授權契約書

ITRI通過獲經濟部委聘執行半導體光源及應用關鍵性技術發展四年計劃，實現了相關技術（「此技術」）。我們與ITRI簽訂了授權契約書，ITRI同意我們可使用、執行、改裝及修改此技術。ITRI亦同意我們可使用及執行根據此技術生產或組裝之產品。此技術屬於ITRI。授權費為新台幣2百萬元，並由我們承擔相關稅項。授權契約書有效期為自2015年10月9日起十年。

根據我們台灣法律顧問告知，委託契約書及授權契約書項下條款並未違反台灣法律法規，我們確認該等協議為有效且對契約雙方具有約束力。

業 務

物業權益

我們的自有物業

於最後實際可行日期，我們(i)在台灣擁有一幅土地，我們已於其上興建總部大樓；及(ii)該工業綜合大樓，包括我們的總部、車間、辦公室及倉庫。據我們的台灣法律顧問告知，於最後實際可行日期，我們已就我們的自有物業取得適當的業權證書。

物業	地點	物業用途	概約 建築面積
土地	台灣新竹縣30244竹北市 保泰三路80號／新竹縣 竹北市東華段1021地號	我們的工業綜合 大樓	2,813.68 平方米
工業綜合大樓	台灣新竹縣30244竹北市 保泰三路80號	3層高地庫連地庫 的樓宇，用作 我們的總部、 車間、潔淨室、 辦公室及倉庫	6,354.52 平方米

有關我們物業權益的進一步詳情，請參閱本文件附錄三「估值報告」。

於最後實際可行日期，我們並無租賃任何重大物業。

知識產權

於最後實際可行日期，本集團在台灣申請註冊三個商標、在中國申請註冊兩個商標及在美國申請註冊三個商標，並為域名www.genestech.com的擁有人。我們知識產權的詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料—B.有關本集團業務的進一步資料—2.本集團的知識產權」一節。

於最後實際可行日期，我們並不知悉有任何第三方侵害或在未經授權下使用我們的知識產權。據我們所知，我們或我們任何附屬公司均沒有任何尚待了結或面臨威脅的有關侵犯第三方知識產權的索償。

業 務

獎項和認證

自成立以來，我們在半導體行業榮獲多個獎項和認可。下表載列本集團獲得較為值得注意的獎項和認證：

獎項年份	獎項	獎項機構
2016年	6號加工廠熱爐管工具運送及安裝進度的感謝	客戶A
2015年	最佳戰略合作夥伴	客戶B
2015年	認可獎項	客戶A
2015年	熱爐管工具安裝的世界紀錄(90.58小時)	客戶B
2010年	促進3號加工廠重要產能改進的努力致謝	客戶A

證書、執照及許可證

我們的台灣法律顧問已確認，靖洋科技已取得進行其註冊業務所有必要的營業執照、批文、證書及許可證，目前所有該等文件均為有效及符合台灣所有重大的適用法律及法規。下表載列本集團取得的認證：

性質	認證	頒發組織或機構	有效期
質量管理體系認證	ISO 9001 : 2008	TQCS International Pty Ltd	直至2018年3月5日

僱員

於最後實際可行日期，本集團有104名僱員。我們所有員工均為於台灣的全職僱員。下表載列於2014年、2015年、2016年12月31日及最後實際可行日期按職能劃分的僱員人數：

職能	於2014年 12月31日的 僱員人數	於2015年 12月31日的 僱員人數	於2016年 12月31日的 僱員人數	於最後實際 可行日期的 僱員人數
董事	3	3	3	3
工程師	44	44	50	50
財務及行政	7	16	14	14
採購	4	8	8	8
質量控制	7	6	6	6
業務發展	14	18	17	17
研發	5	6	6	6
總計	<u>84</u>	<u>101</u>	<u>104</u>	<u>104</u>

業 務

我們董事相信，我們僱員具備半導體製造設備行業的行業經驗和實踐理解是確保我們業務發展的重要因素。我們提供在職培訓，並鼓勵僱員增進知識。我們也安排僱員參加貿易展覽，以緊貼半導體製造設備行業技術趨勢的變化。

我們主要在公開市場及透過內部推薦招聘僱員，並利用互聯網廣告及在公司網站刊登職位空缺廣告。我們可依靠專業人才招聘公司聘用高級職位。於業績記錄期間，我們並無支付任何介紹費予招聘代理。

於業績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們概無與僱員產生重大糾紛或因勞資糾紛使我們的營運中斷，且在聘請及挽留經驗豐富或技術精湛的員工方面並無遇到任何困難。於業績記錄期間及直至最後實際可行日期，本集團已成立僱員福利委員會。

據我們的台灣法律顧問確認，倘靖洋科技將與其僱員訂立的僱傭合約樣板獲訂約方正式簽署，即屬合法並對雙方具有約束力，並無違反相關僱傭法律及法規的任何條文。一般來說，我們基於每名僱員的資質、職位和年資而決定僱員薪金。

據我們的台灣法律顧問表示，根據有關當局的確認，就彼等所深知，我們於業績記錄期間一直於各重大方面遵守適用的僱傭法例。

職業安全和健康措施

我們須遵守台灣若干職業健康和安法例。為確保僱員在工作流程中的職業安全和健康，我們已採取多項措施，如提供有關設備操作和工地安全的定期培訓課程，以及使用防護設備。我們也要求僱員遵守「6S」的方式，有關方式牽涉到我們的內部管理系統，包括整理(Seiri)、整頓(Seition)、清掃(Seiso)、清潔(Seiketsu)、素養(Shitsuke)及安全(Safety)。我們安全及環境部門的安全經理定期對設施進行安全檢查，以確保符合安全措施及遵照工作程序。我們已建立內部指引以助員工保持工作環境安全、正確操作機械及預防意外事故。

據我們董事確認，於業績記錄期間，我們的生產設施未有發生重大的工傷或致命事故，以及於最後實際可行日期，我們未有遭受任何人身或財產損害賠償的重大索賠。

環境保護

根據我們營運所在司法管轄區的適用國家或本地環保法律及法規，我們毋須就主要業務向任何環境保護局取得批文或許可證。

業 務

由於我們的業務性質使然，本集團的經營活動不會直接產生工業污染，而本集團的業務於業績記錄期間並無就適用的環保規則及規例直接產生任何合規成本。我們董事預期，本集團日後將不會就遵守適用環保規則及規例直接產生任何巨額成本。於最後實際可行日期，本集團並無就任何適用的環保法例及規例遇到任何重大不合規事宜。

保 險

就我們的營運而言，我們為僱員投購強制性保險及福利，包括人壽保險、醫療保險及健康保險。基於我們所相信的台灣行業慣例，我們並無為高級管理團隊任何成品投購產品責任保險或主要人員保險。請參閱本文件「風險因素—有關我們業務及營運的風險—我們可能並無充足的保險保障」一段。於業績記錄期間，我們並無經歷任何嚴重意外或重大產品責任索償，而董事認為，我們的保險保障足夠及與台灣行業慣例一致。我們將繼續監察我們的風險狀況及於需要時對我們的保險慣例作出調整。

競 爭

根據弗若斯特沙利文報告，半導體製造設備供應商市場高度集中，按收入計算，五大參與者佔2015年總全球市場份額的63.9%。台灣方面，儘管原設備製造商也提供統包解決方案，統包解決方案供應商一般專門製造若干半導體製造設備品牌，因此需要具有設備的專門知識以取得業務。統包解決方案供應商的整體市場分散，眾多私人公司參與不同品牌設備的統包業務。於2015年，我們貢獻收益新台幣8.8億元，佔台灣統包解決方案市場份額4.7%。此外，就日本品牌的二手半導體製造設備及零件而言，本集團被視為台灣領先統包解決方案供應商及出口商之一。

面對我們業務所在行業的競爭，我們相信我們的競爭優勢為本集團帶來成功，在經驗豐富的董事及高級管理層管理下，本集團處於有利位置，能夠迎合中國包解決方案業務的需求增長。有關我們競爭優勢的更多詳情，請參閱本節「業務—我們的競爭優勢」一段。

法律訴訟及監管合規

法律訴訟

於最後實際可行日期，本公司及董事概無涉及任何尚未了結並對我們的財務狀況或經營業績造成重大不利影響的訴訟、仲裁或申索，且概無重大訴訟、仲裁或行政程序已對本公司構成威脅。

業 務

監管合規

我們的董事確認，於業績記錄期間及直至最後實際可行日期，概無任何重大不合規事件。

企業管治措施

我們深明實現高水平企業管治標準的價值及重要性以加強企業表現、透明度及問責性，從而贏得股東及社會大眾的信心。為遵守創業板上市規則的規定，特別是創業板上市規則附錄十五載列的企業管治守則（「守則」）所載的守則條文，我們已於最後實際可行日期採納以下措施：

- (i) 我們已成立審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，並根據守則所載的守則條文訂立各自的書面職權範圍。進一步資料載於本文件「董事及高級管理層—董事會委員會」一節；
- (ii) 董事會已根據守則的守則條文採納有關企業管治及股東通訊政策的職權範圍；
- (iii) 我們將於[編纂]前就因企業活動所產生針對董事的法律訴訟為董事責任投購合適保險；
- (iv) 我們已委任三名獨立非執行董事，佔董事會人數一半以上，而其中至少一名具備會計專業知識；
- (v) 除非細則另有規定，董事將根據細則行事，其中規定擁有權益的董事，於批准其本人或其任何緊密聯繫人擁有重大權益的任何合約或安排或其他建議的任何董事會決議案時，不得投票（亦不得計入法定人數內）；
- (vi) 根據守則，董事（包括獨立非執行董事）將能夠於適當情況下向外尋求獨立專業意見，費用由我們支付；
- (vii) 本公司將參考守則採納一套全面的公司政策，涵蓋法律及監管合規事宜；
- (viii) 本公司將考慮委聘一名獨立內部監控顧問，就企業管治進行定期檢討以確保在[編纂]後持續合規；及
- (ix) 董事將出席專業發展研討會，包括但不限於企業管治，以確保在[編纂]後持續合規。